

# 半导体

## 华为 Mate XT 开启预定，看好华为产业链投资机会

上周 (09/02-09/06) 半导体行情落后于大部分主要指数。上周创业板指数下降 2.68%，上证综指下跌 2.69%，深证综指下降 2.61%，中小板指下降 2.95%，万得全 A 下降 2.50%，申万半导体行业指数下降 5.88%。半导体各细分板块有涨有跌，其他板块涨幅最大，封测板块跌幅最大。半导体细分板块中，封测板块上周下降 6.7%，半导体材料板块上周下降 5.1%，分立器件板块上周下降 4.7%，IC 设计板块上周下降 4.1%，半导体设备板块上周下降 5.6%，半导体制造板块上周下降 4.1%，其他板块上周上涨 32.0%。

**华为 Mate XT 开启预定，看好华为产业链投资机会。**根据华为商城，Mate XT 作为首款三折手机，于 9 月 7 日 12:08 开始预约，将于 9 月 20 日正式开售，该产品是全球首款三折手机，预约期间有玄黑、瑞红两款颜色以及 16GB+512GB、16GB+1TB 两款存储容量可选，截至 9 月 8 日全网预约量已超 200 万部。此外，华为官网显示，9 月 19-21 日还将举办 2024 华为全联接大会。三季度进入到消费电子新机发布密集期，我们看好华为手机市场反馈超预期带来的全产业链加单效应，看好产业链投资机会。

**全球 7 月半导体销售额创年内新高，中国区同比增速达 19.5%。**美国半导体行业协会 (SIA) 9 月 3 日宣布，2024 年 7 月全球半导体行业销售额达到 513 亿美元，较 2023 年 7 月的 432 亿美元增长 18.7%，比 2024 年 6 月的 500 亿美元增长 2.7%。其中，中国区为 152.3 亿美元，同比增长 19.5%，增速显著。我们预计随着三季度进入传统旺季，月度销售额趋势有望持续环比增长，看好 AI 作为本轮产业周期的主要推动力，关注相关 AI 终端的市场销售进展。**美国再次加强半导体等关键技术出口管制，设备材料国产替代值得关注。**美国商务部 5 日通告，出于国家安全和外交政策的原因，更新量子计算、半导体制造和其他先进技术的管制政策。对下述物项，BIS 将进行全球范围内的出口管制：量子计算机及其相关设备、组件、材料、软件和技术，可用于量子计算机的开发和维护；生产先进半导体设备所必需的工具和设备；栅极全方位场效应晶体管(GAAFET)技术，即生产或开发可用于超级计算机的高性能计算芯片的技术；增材制造项目 (Additive Manufacturing)，即用于生产金属或金属合金部件的设备、部件及相关技术和软件。我们认为在美国持续加码半导体出口管制的背景下，设备材料国产替代对本土半导体产业链的安全运转具有重要意义，相关设备材料厂商有望受益于国产替代趋势。

### 建议关注：

- 1) 半导体设计：汇顶科技/思特威/扬杰科技/瑞芯微/恒玄科技/普冉股份/江波龙 (天风计算机联合覆盖) /东芯股份/复旦微电/钜泉科技/晶晨股份/力合微/全志科技/乐鑫科技/寒武纪/龙芯中科/海光信息 (天风计算机覆盖) /北京君正/澜起科技/聚辰股份/帝奥微/纳芯微/圣邦股份/中颖电子/斯达半导/宏微科技/东微半导/民德电子/思瑞浦/新洁能/兆易创新/韦尔股份/艾为电子/卓胜微/晶丰明源/希荻微/安路科技/中科蓝讯
- 2) 半导体材料设备零部件：金海通/鸿日达/精测电子 (天风机械联合覆盖) /天岳先进/国力股份/新莱应材/雅克科技 /长川科技 (天风机械覆盖) /联动科技/茂莱光学/艾森股份/正帆科技 (天风机械联合覆盖) /江丰电子/北方华创/富创精密/沪硅产业/上海新阳/中微公司/鼎龙股份 (天风化工联合覆盖) /安集科技/盛美上海/中巨芯/清溢光电/有研新材/华特气体/南大光电/凯美特气/和远气体 (天风化工联合覆盖)
- 3) IDM 代工封测：伟测科技/华虹半导体/中芯国际/长电科技/通富微电；时代电气/士兰微/扬杰科技/闻泰科技/三安光电
- 4) 卫星产业链：海格通信/电科芯片/复旦微电/北斗星通/利扬芯片

**风险提示：**地缘政治带来的不可预测风险，需求复苏不及预期，技术迭代不及预期，产业政策变化风险

## 证券研究报告

2024 年 09 月 11 日

### 投资评级

行业评级 强于大市(维持评级)  
上次评级 强于大市

### 作者

潘暕 分析师  
SAC 执业证书编号：S1110517070005  
panjian@tfzq.com

骆奕扬 分析师  
SAC 执业证书编号：S1110521050001  
luoyiyang@tfzq.com

程如莹 分析师  
SAC 执业证书编号：S1110521110002  
chengruiying@tfzq.com

李泓依 分析师  
SAC 执业证书编号：S1110524040006  
lihongyi@tfzq.com

### 行业走势图



资料来源：聚源数据

### 相关报告

- 1 《半导体-行业研究周报:半导体 2Q24 总结：行业盈利水平改善明显，关注 AI 对半导体需求拉动》 2024-09-06
- 2 《半导体-行业研究周报:看好“5+2 智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长》 2024-08-27
- 3 《半导体-行业研究周报:看好“5+2 智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长》 2024-08-20

## 内容目录

1. 上周观点：华为 Mate XT 开启预定，看好华为产业链投资机会.....	3
2. 半导体产业宏观数据：24 年半导体销售恢复中高速增长，存储成关键.....	3
3. 8 月芯片交期及库存：主要芯片类别货期短期趋稳.....	5
4. 8 月产业链各环节景气度：.....	11
4.1. 设计：库存去化效益显现，需求复苏有望带动基本面持续向好.....	11
4.1.1. 存储：渠道市场需求小幅增加，嵌入式市场价格保持稳定.....	11
4.2. 代工：整体代工产能及订单有所复苏，部分代工价格或上涨.....	17
4.3. 封测：AI、高端消费电子等先进封测需求快速增长，产能利用率快速回升.....	19
4.4. 设备材料零部件：7 月，可统计设备中标数量 70 台，招标数量 118 台.....	20
4.4.1. 设备及零部件中标情况：7 月可统计设备中标数量 70 台，国内零部件中标数量同比+200%.....	20
4.4.2. 设备招标情况：7 月可统计设备招标数量 118 台，同比下降 14.49%.....	23
4.5. 分销商：分化态势明显，中国为代表的亚太地区市场快速回升，主要品类价格逐步企稳.....	25
5. 终端应用：看好消费电子复苏，关注元宇宙发展走势.....	25
5.1. 消费电子：全球智能手机及 PC 等消费类需求维持弱势复苏，AI+ 相关应用增长较快，XR 需求增长持续低迷.....	25
5.2. 新能源汽车：汽车需求分化，市场竞争加剧，谨慎评估最新各国电车政策对于国产电车及供应链冲击。.....	26
5.3. 工控：工控订单增长低于预期，库存去化持续但仍处较高水平.....	27
5.4. 光伏：光伏行业竞争加剧，价格持续承压，欧洲市场库存仍较高.....	27
5.5. 储能：全球储能需求旺盛，中国市场价格竞争加剧，欧洲市场库存去化下需求放缓.....	28
5.6. 服务器：AI 服务器需求保持强劲，通用服务器需求也逐渐反弹.....	28
5.7. 通信：通信业务增长低迷，头部厂商逐步剥离部分资产以降低成本.....	29
6. 上周（09/02-09/06）半导体行情回顾.....	29
7. 上周（09/02-09/06）重点公司公告.....	30
8. 上周（09/02-09/06）半导体重点新闻.....	31
9. 风险提示.....	31

## 1. 上周观点：华为 Mate XT 开启预定，看好华为产业链投资机遇

**华为 Mate XT 开启预定，看好华为产业链投资机遇。**根据华为商城，Mate XT 作为首款三折手机，于 9 月 7 日 12:08 开始预约，将于 9 月 20 日正式开售，该产品是全球首款三折手机，预约期间有玄黑、瑞红两款颜色以及 16GB+512GB、16GB+1TB 两款存储容量可选，截至 9 月 8 日全网预约量已超 200 万部，市场反馈大超预期。此外，华为官网显示，9 月 19-21 日还将举办 2024 华为全联接大会。三季度进入到消费电子新机发布密集期，我们看好华为手机市场反馈超预期带来的全产业链加单效应，看好产业链投资机会。

**全球 7 月半导体销售额创年内新高，中国区同比增速达 19.5%。**美国半导体行业协会 (SIA) 9 月 3 日宣布，2024 年 7 月全球半导体行业销售额达到 513 亿美元，较 2023 年 7 月的 432 亿美元增长 18.7%，比 2024 年 6 月的 500 亿美元增长 2.7%。其中，中国区为 152.3 亿美元，同比增长 19.5%，增速显著。我们预计随着三季度进入传统旺季，月度销售额趋势有望持续环比增长，看好 AI 作为本轮产业周期的主要推动力，关注相关 AI 终端的市场销售进展。

**美国再次加强半导体等关键技术出口管制，设备材料国产替代值得关注。**美国商务部 5 日通告，出于国家安全和外交政策的原因，更新量子计算、半导体制造和其他先进技术的管制政策。对下述物项，BIS 将进行全球范围内的出口管制：量子计算机及其相关设备、组件、材料、软件和技术，可用于量子计算机的开发和维护；生产先进半导体设备所必需的工具和设备；栅极全方位场效应晶体管(GAAFET)技术，即生产或开发可用于超级计算机的高性能计算芯片的技术；增材制造项目 (Additive Manufacturing)，即用于生产金属或金属合金部件的设备、部件及相关技术和软件。我们认为在美国持续加码半导体出口管制的背景下，设备材料国产替代对本土半导体产业链的安全运转具有重要意义，相关设备材料厂商有望受益于国产替代趋势。

## 2. 半导体产业宏观数据：24 年半导体销售恢复中高速增长，存储成关键

从 2024 年 8 月景气度分析及多家半导体行业头部分销商发展预期来看，各家下半年增长预期维持乐观，亚太地区尤其是中国市场仍旧是增长关键，建议关注下半年传统旺季带来的业绩增量。

表 1：2024H1 元器件分销商订单及发展预期

厂商	2024H1 订单	具体内容	2024H2 发展预期
艾睿电子	下降	汽车和更广泛的工业市场仍然疲软;欧美市场需求疲软，中国需求增长和价格稳定;整体订单有所改善	下半年订单改善，需求回升
安富利	下降	电子元器件业务在全球范围下降，但是亚洲地区触底明显	下半年相对上半年有增长;其中亚洲市场将恢复整体同比增长
大联大	上升	AI 及 PC 回温下元器件需求增长	下半年营运在服务器与 AI PC 等应用带动下，可乐观看待
文晔科技	上升	数据中心及通讯相关产品增长迅猛	数据中心增长维持高景气度，下半年手机、PC 等消费型迎来消费旺季，叠加通讯需求增长，公司营收有机会逐季成长

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

行业内多家主流机构都比较看好 2024 年的半导体行情。其中，WSTS 表示因生成式 AI 普及、带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因此 2024 年全球半导体销售额将增长 13.1%，金额达到 5,883.64 亿美元，再创历史新高；IDC 的看法比 WSTS 乐观，其认为 2024 年全球半导体销售额将达到 6328 亿美元，同比增长 20.20%；此外，Gartner 也认为 2024 年全球半导体销售额将迎来增长行情，增长幅度将达到 16.80%，金额将达到 6328 亿美元。

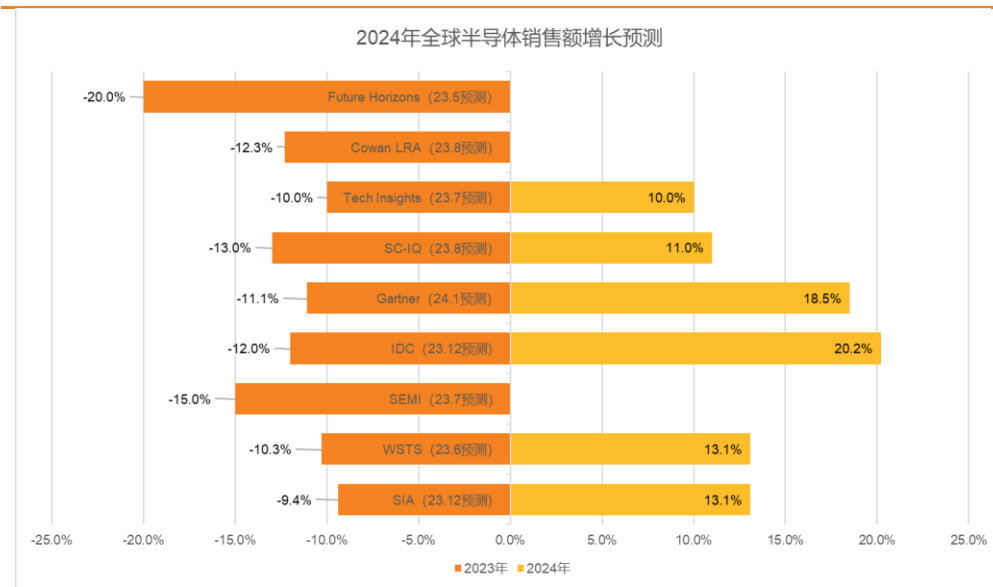
表 2：主流机构对半导体 2024 年的看法

机构名称	2023 年金额(亿美元)	比例	2024 年金额(亿美元)	比例
Gartner	5322	-11%	6328	16.80%
WSTS	5201.26	-9.40%	5883.64	13.10%
IDC	5265	-12%	6328	20.20%

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

从全球半导体销售额看，2023 年半导体行业筑底已基本完成，从 Q3 厂商连续数月的稳定增长或奠定半导体行业触底回升的基础。全球部分主流机构/协会上修 2024 年全球半导体销售额预测，2024 年芯片行业将出现 10%-18.5% 之间的两位数百分比增长。其中，IDC 和 Gartner 最为乐观，分别预测增长达 20.2% 和 18.5%。

图 1：各机构 2024 年全球半导体销售额增长猜测



资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

从细分品类看，WSTS 预计 2024 年增速最快的前三名是存储、逻辑和处理器，分别增长 44.8%、9.6% 和 7.0%。其他品类中，光电子增速最低，约 1.7%；模拟芯片受库存去化及需求低迷影响，增速约 3.7%。总的来看，存储产品或将成为 2024 年全球半导体市场复苏关键，销售额有望恢复 2022 年水平。

**半导体产业宏观数据：**根据 SIA 最新数据，2024 年 6 月全球半导体市场销售额为 499.8 亿美元，同比增长 18.3%，环比增长 1.7%，市场需求维持高景气度。从各区域市场看，美洲市场增长最为强劲，同比增长达 42.8%，中国中国大陆地区同比增长 21.6%，其他地区如欧洲和日本均分别下降 -11.2%、-5.0%。从 2024Q2 增长势头看，全球半导体市场保持强劲，季度销售额自 2023Q4 以来实现首次增长。

图 2：全球半导体销售额

图 3：中国集成电路产量



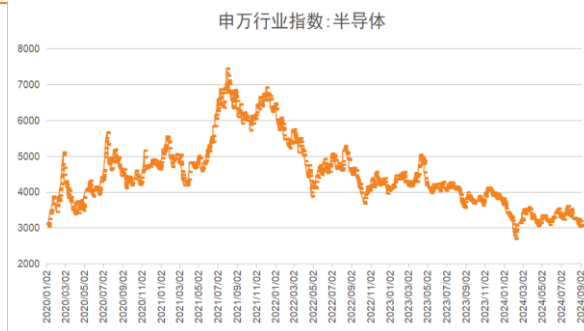
资料来源：SIA，芯八哥公众号，天风证券研究所



资料来源：工信部、SIA、芯八哥公众号，天风证券研究所

**半导体指数走势：**2024年8月，中国半导体（SW）行业指数下跌9.8%，费城半导体指数（SOX）上升6.2%。

图 4：中国半导体（sw）行业指数



资料来源：iFinD，天风证券研究所

图 5：费城半导体指数（sox）

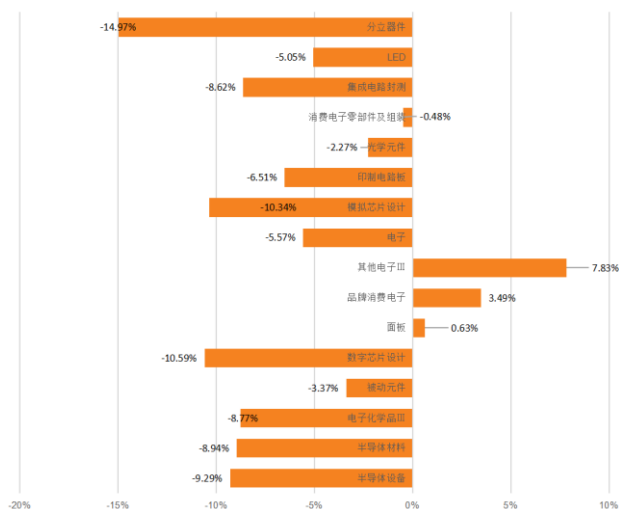


资料来源：iFinD，天风证券研究所

2024年8月，申万指数各电子细分板块涨跌不一。涨幅居前三名分别为其他电子Ⅲ（7.83%）、品牌消费电子（3.49%）、面板（0.63%）。跌幅居前三名分别为分立器件（-14.97%）、数字芯片设计（-10.59%）和模拟芯片设计（-10.34%）。

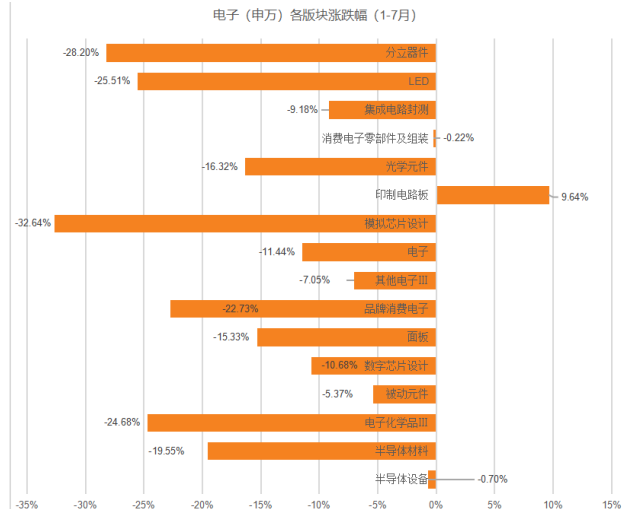
2024年1-8月，申万指数各电子细分板块大部分出现较大幅度下跌。仅印刷电路板呈现涨幅（9.64%）。跌幅居前三名分别为模拟芯片设计（-32.64%）、分立器件（-28.20%）和LED（-25.51%）。

图 6：电子（申万）各板块涨跌幅（24年8月）



资料来源：iFinD，天风证券研究所

图 7：电子（申万）各板块涨跌幅（2024年1-8月）

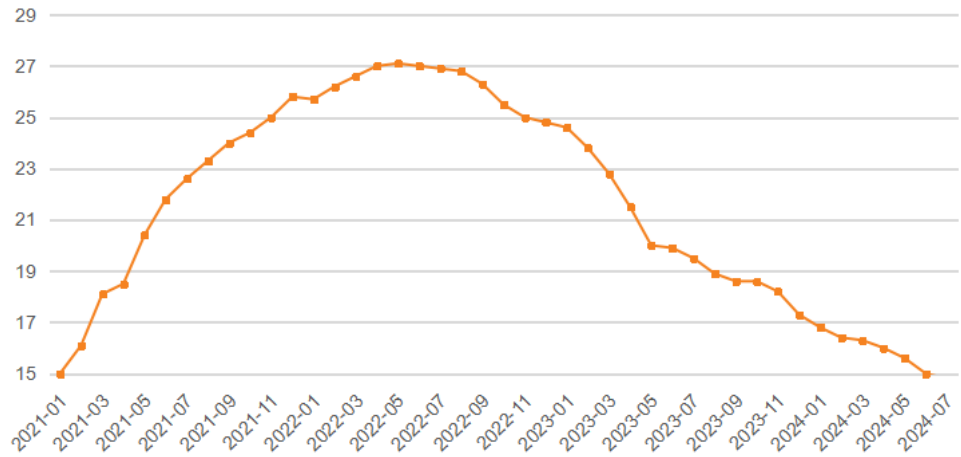


资料来源：iFinD，天风证券研究所

### 3.8 月芯片交期及库存：主要芯片类别货期短期趋稳

**整体芯片交期趋势：**8月，主要芯片交期回归正常并持续稳定，汽车及AI部分品类波动明显。

图 8：全球芯片平均交货周期（周）



资料来源：芯八哥公众号，Susquehanna Financial Group，天风证券研究所

**重点芯片供应商交期：**8月，芯片交期趋稳，部分产品价格倒挂。其中，PMIC为代表模拟芯片价格倒挂明显延续；射频及无线产品价格有所回调；分立器件交期持续缩短，价格稳定；MCU 货期稳定，中低端产品价格低位；存储和 MLCC 等回升明显。

表 3：头部厂商 8 月交期及趋势

类别	供应商	产品	24.8 交期/周	24.9 交期/周	交期趋势	价格趋势
模拟	AMSOSRAM	传感器	8-24	8-24	稳定	根据市场调整
	BOSCH	传感器	6-12	6-12	稳定	稳定
	Diodes	多源模拟/电源	10-20	10-20	稳定	稳定
		开关稳压器	12-24	12-24	稳定	稳定
	FTDI Chip	接口	14-20	14-20	缩短	稳定
	Infineon	传感器	4-26	4-26	稳定	稳定
		开关稳压器	14-30	14-30	稳定	稳定
		汽车模拟和电源	36-45	36-45	缩短	稳定
	ADI (Maxim)	放大器和数据转换器	12-26	12-24	稳定	稳定
		接口	14-25	14-25	稳定	稳定
		开关稳压器	14-30	14-26	稳定	稳定
	Microchip	放大器和数据转换器	4-10	4-10	稳定	稳定
		定时	7-12	7-12	缩短	稳定
		开关稳压器	8-20	8-20	稳定	稳定
	MPS	开关稳压	12-24	12-24	稳定	稳定

		器				
	NXP	传感器	16-52	16-52	稳定	稳定
		接口	16-24	16-20	缩短	稳定
		汽车模拟和电源	20-30	16-26	缩短	稳定
	onsemi	传感器	18-52	18-52	稳定	根据市场调整
		放大器和数据转换器	10-20	10-20	缩短	稳定
		定时	20-42	24-30	稳定	稳定
		多源模拟/电源	10-28	10-28	缩短	稳定
		开关稳压器	10-26	10-26	稳定	稳定
	Panasonic	传感器	16-26	16-26	延长	稳定
	Renesas	放大器和数据转换器	24-36	16-24	缩短	稳定
		定时	50	34-36	稳定	稳定
		接口	20-30	20-30	稳定	稳定
		开关稳压器	12-26	12-26	稳定	稳定
	ROHM	传感器	24-52	24-52	延长	上升
		开关稳压器	12-26	12-26	稳定	稳定
	ST	传感器	12-20	20-34	稳定	稳定
		放大器和数据转换器	10-20	10-20	缩短	稳定
		多源模拟/电源	10-20	10-20	缩短	稳定
		开关稳压器	10-20	10-20	稳定	稳定
		汽车模拟和电源	30-40	24-38	缩短	稳定
	TE	传感器	16-52	16-52	延长	根据市场调整
	Vishay	传感器	24-52	24-52	延长	稳定
射频和无线	Infineon	蓝牙模块	16-24	16-24	稳定	稳定
	Microchip	WiFi 模块	12-20	12-20	稳定	稳定
		蓝牙模块	12-20	12-20	稳定	稳定
		收发器/接收器	12-20	12-20	稳定	稳定
	Murata	WiFi 模块	26-50	26-50	稳定	稳定
		蓝牙模块	26-50	26-50	稳定	稳定
	Larid	WiFi 模块	16-36	16-36	稳定	稳定
		天线	12-16	12-16	延长	稳定

分立器件	ST	蓝牙模块	10-12	10-12	稳定	稳定
		收发器/接收器	12	12	稳定	稳定
		RFID	20	20	稳定	稳定
	NXP	收发器/接收器	24	24	稳定	上升
		RFID	13	13	稳定	稳定
		大功率 IC	12-16	12-16	稳定	稳定
	onsemi	蓝牙模块	16-30	16-30	稳定	稳定
	Diodes	低压 MOSFET	8-16	8-14	缩短	根据市场调整
		TVS 二极管	6-12	6-12	缩短	稳定
		桥式整流器	8-15	8-15	稳定	稳定
		肖特基二极管	8-12	8-12	稳定	稳定
		整流器	8-13	8-13	稳定	稳定
开关二极管		8-12	8-12	稳定	稳定	
小信号 MOSFET		8-12	8-12	稳定	稳定	
齐纳二极管		8-12	8-12	稳定	稳定	
双极晶体管		8-12	8-12	稳定	稳定	
数字晶体管/RETS		8-12	8-12	稳定	稳定	
通用晶体管		8-12	8-12	稳定	稳定	
逻辑器件		8-10	8-10	稳定	稳定	
Infineon	低压 MOSFET	10-36	10-20	缩短	根据市场调整	
	高压 MOSFET	10-32	10-20	缩短	稳定	
	IGBT	14-52	12-42	缩短	稳定	
	宽带隙 MOSFET	18-40	13-36	稳定	稳定	
	数字晶体管/RETS	6-40	6-30	稳定	稳定	
	通用晶体管	6-50	6-50	稳定	稳定	
	军用-航空晶体管	20-40	20-30	稳定	稳定	
ST	低压 MOSFET	50-54	13-41	缩短	稳定	
	高压	14-40	13-39	缩短	稳定	



		MOSFET				
		IGBT	12-52	14-52	缩短	稳定
		ESD	16-18	16-18	缩短	稳定
		宽带隙 MOSFET	42-52	32-52	稳定	稳定
		晶闸管 / Triac	15-16	15-16	稳定	稳定
		TVS 二极管	16-18	16-18	稳定	根据市场调整
		整流器	14-16	14-16	稳定	稳定
		双极晶体管	16-40	12-24	稳定	稳定
	Wingtech ( Nexperia )	低压 MOSFET	6-20	12-24	缩短	根据市场调整
		ESD	6-18	6-16	稳定	稳定
		肖特基二极管	4-8	4-9	稳定	稳定
		开关二极管	4-8	6-10	稳定	稳定
		小信号 MOSFET	6-8	6-8	稳定	稳定
		齐纳二极管	4-8	4-9	缩短	稳定
		双极晶体管	4-8	4-9	稳定	稳定
		数字晶体管 / RETS	4-8	4-9	稳定	稳定
		通用晶体管	4-8	4-9	稳定	稳定
		逻辑器件	6-8	6-8	稳定	稳定
		MCU	Renesas	8 位 MCU	8-24	8-24
32 位 MCU	6-12			6-12	稳定	稳定
汽车	10-20			10-20	稳定	稳定
32 位 MPU	12-24			12-24	稳定	稳定
ST	8 位 MCU		14-20	14-20	缩短	稳定
	汽车		4-26	4-26	稳定	稳定
	32 位 MPU		14-30	14-30	稳定	稳定
	STM32FO		36-45	36-45	缩短	稳定
	STM32FO		12-26	12-24	稳定	稳定
	STM32L		14-25	14-25	稳定	稳定
	32 位 MCU		14-30	14-26	稳定	稳定
Infineon	8 位 MCU		4-10	4-10	稳定	稳定
	32 位 MCU		7-12	7-12	缩短	稳定
	汽车		8-20	8-20	稳定	稳定
Microchip	8 位 MCU		12-24	12-24	稳定	稳定
	32 位 MCU	16-52	16-52	稳定	稳定	
	32 位 MPU	16-24	16-20	缩短	稳定	

	NXP	8 位 MCU	20-30	16-26	缩短	稳定
		32 位 MCU	18-52	18-52	稳定	根据市场调整
		汽车	10-20	10-20	缩短	稳定
		32 位 MPU	20-42	24-30	稳定	稳定
可编程逻辑器件	AMD (Xilinx)	FPGA	10-28	10-28	缩短	稳定
	Intel (Altera)		10-26	10-26	稳定	稳定
	Lattice		16-26	16-26	延长	稳定
	Microchip (Microsemi)		24-36	16-24	缩短	稳定
存储器	Samsung	DRAM (商用 PC)	50	34-36	稳定	稳定
		存储器模块	20-30	20-30	稳定	稳定
		eMMC	12-26	12-26	稳定	稳定
		固态驱动 (SSD)	24-52	24-52	延长	上升
	SK Hynix	NANDflash	12-26	12-26	稳定	稳定
		eMMC	12-20	20-34	稳定	稳定
被动元件	Murata	滤波器	10-20	10-20	缩短	稳定
		电感/变压器	10-20	10-20	缩短	稳定
		引线陶瓷电容	10-20	10-20	稳定	稳定
		专用电容	30-40	24-38	缩短	稳定
	TDK	滤波器	16-52	16-52	延长	根据市场调整
		电感/变压器	24-52	24-52	延长	稳定
		表面贴装通用陶瓷电容 (车规级)	16-24	16-24	稳定	稳定

资料来源：芯八哥公众号，富昌电子，Wind，天风证券研究所

**头部企业订单及库存情况：**8 月，消费类订单缓慢增长，库存正常；汽车订单分化，库存较高；工业类订单改善，库存稳定；通信订单疲软；新能源和 AI 订单需求强劲，光伏库存风险仍存。

图 9：头部厂商 8 月订单及库存

公司	8月订单	8月库存	9月订单预测	9月库存预测
Intel	上升	低	上升	低
AMD	上升	低	上升	低
NVIDIA	上升	无	上升	无
三星	上升	低	上升	下降
TI	下降	较高	下降	下降
ST	稳定	一般	稳定	一般
ADI	下降	一般	下降	一般
Qualcomm	上升	一般	上升	下降
Broadcom	上升	低	上升	低
NXP	下降	一般	稳定	较低
Infineon	下降	一般	稳定	较低
Renesas	稳定	低	稳定	一般
Onsemi	下降	低	稳定	低
Microchip	下降	一般	稳定	一般
Micron	上升	低	上升	低
SK Hynix	上升	低	上升	低
Murata	上升	低	上升	低
联发科	上升	低	上升	低

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

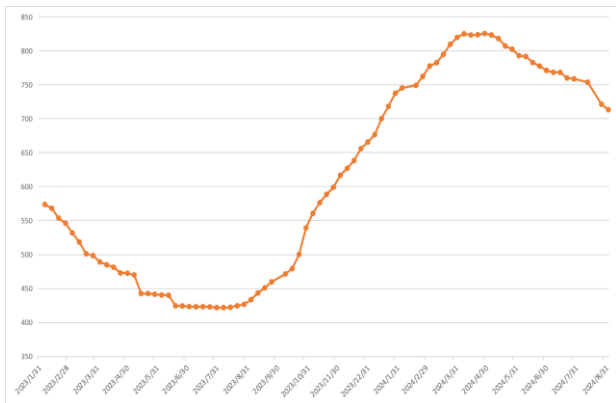
## 4. 8月产业链各环节景气度：

### 4.1. 设计：库存去化效益显现，需求复苏有望带动基本面持续向好

#### 4.1.1. 存储：渠道市场需求小幅增加，嵌入式市场价格保持稳定

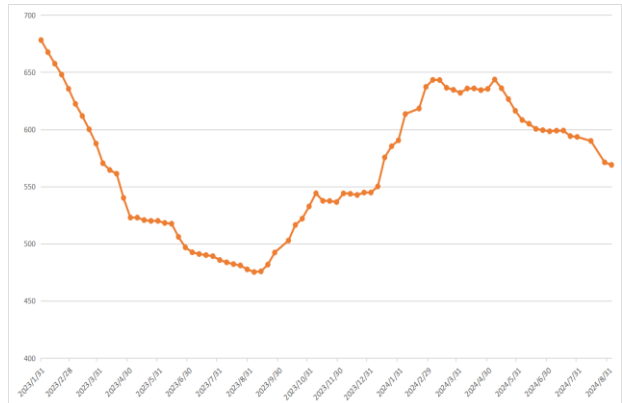
根据闪存市场公众号对存储行情的周度(截至 2024.09.03)评述，本周渠道市场经历了数周下跌后，9月价格开始稳定，嵌入式市场保持不变。行业 SSD 和内存条价格小幅下调。去年 PC OEM 出货量受需求疲软、库存过剩和疫情影响，今年全球 PC 市场出货量个位数增长，国内部分厂商出货量双位数下滑。三季度国内 PC 需求依旧低迷，行业 SSD 和内存条供过于求。9月是存储品牌厂商关键战略期，海外 PC 厂商会提前备货迎“黑五”和圣诞。嵌入式市场方面，原厂资源供应不稳定，存储品牌厂商在新制程产品导入上推进速度不一，成功导入的厂商将占优势。

图 10：NAND 价格指数



资料来源：闪存市场官网，天风证券研究所

图 11：DRAM 价格指数



资料来源：闪存市场官网，天风证券研究所

上游资源方面，Flash Wafer 和部分 DDR 颗粒继续小幅调降。其中，1Tb QLC/1Tb TLC/512Gb TLC/256Gb TLC NAND Flash Wafer 价格已下调至 6.20/7.10/3.80/1.60 美元，DDR4 8Gb 3200/8Gb eTT 分别下调至 1.32/1.12 美元，DDR4 16Gb 3200/16Gb eTT/4Gb eTT 价格不变。

图 12：Flash Wafer 最新报价（当前价为美元）（09/03）

产品名称	当前价	前收盘	涨跌
1Tb QLC	6.20	6.40	-3.13%
			-0.2
1Tb TLC	7.10	7.20	-1.39%
			-0.1
512Gb TLC	3.80	3.90	-2.56%
			-0.1
256Gb TLC	1.60	1.75	-8.57%
			-0.15

资料来源：闪存市场官网，天风证券研究所

图 13：DDR 最新报价（当前价为美元）（09/03）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
DDR4 16Gb 3200	2.97	2.97	0.00%
			0.00
DDR4 16Gb eTT	2.65	2.65	0.00%
			0.00
DDR4 8Gb 3200	1.32	1.33	-0.75%
			-0.01
DDR4 8Gb eTT	1.12	1.13	-0.88%
			-0.01
DDR4 4Gb eTT	0.69	0.69	0.00%
			0.00

资料来源：闪存市场官网，天风证券研究所

渠道市场方面，尽管受到热门游戏《黑神话：悟空》的短期推动，渠道市场的需求有所上升，但这种小幅增长并不足以对整体市场趋势产生显著影响。此外，虽然部分低端 SSD 产品的价格出现了较大幅度的下降，本周渠道市场的 SSD 和内存条价格总体上还是维持了稳定。行业市场方面，今年初全球 PC 市场出货量同比微增，但国内部分厂商出货量大跌。三季度国内需求不振，扩大了国内外市场差距，导致存储厂商的 SSD 和内存条供过于求，价格小幅下降。

图 14：渠道市场 SSD 最新报价（当前价为美元）（09/03）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
SSD 120GB SATA 3	5.40	5.40	0.00%
			0.00
SSD 240GB SATA 3	10.20	10.20	0.00%
			0.00
SSD 480GB SATA 3	18.30	18.30	0.00%
			0.00
SSD 256GB PCIe 3.0	12.50	12.50	0.00%
			0.00
SSD 512GB PCIe 3.0	22.40	22.40	0.00%
			0.00
SSD 1TB PCIe 3.0	43.00	43.00	0.00%
			0.00
SSD 512GB PCIe 4.0	29.50	29.50	0.00%
			0.00
SSD 1TB PCIe 4.0	46.50	46.50	0.00%
			0.00
SSD 2TB PCIe 4.0	88.00	88.00	0.00%
			0.00

资料来源：闪存市场官网，天风证券研究所

图 16：渠道市场内存条最新报价（当前价为美元）（09/03）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
DDR4 UDIMM 8GB 3200	8.90	8.90	0.00%
			0.00
DDR4 UDIMM 16GB 3200	17.90	17.90	0.00%
			0.00
DDR4 UDIMM 32GB 3200	38.30	38.30	0.00%
			0.00

资料来源：闪存市场官网，天风证券研究所

图 15：行业市场 SSD 最新报价（当前价为美元）（09/03）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
SSD 256GB SATA 3	16.80	17.00	-1.18%
			-0.20
SSD 512GB SATA 3	28.50	29.00	-1.72%
			-0.50
SSD 1TB SATA 3	53.00	55.00	-3.64%
			-2.00
SSD 256GB PCIe 3.0	19.50	20.00	-2.50%
			-0.50
SSD 512GB PCIe 3.0	33.00	33.50	-1.49%
			-0.50
SSD 1TB PCIe 3.0	57.00	59.00	-3.39%
			-2.00
SSD 512GB PCIe 4.0	35.00	36.00	-2.78%
			-1.00
SSD 1TB PCIe 4.0	61.00	62.00	-1.61%
			-1.00
SSD 2TB PCIe 4.0	118.00	120.00	-1.67%
			-2.00

资料来源：闪存市场官网，天风证券研究所

图 17：行业市场内存条最新报价（当前价为美元）（09/03）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
DDR4 SODIMM 4GB 3200	9.50	9.60	-1.04%
			-0.10
DDR4 SODIMM 8GB 3200	15.00	15.50	-3.23%
			-0.50
DDR4 SODIMM 16GB 3200	25.50	26.00	-1.92%
			-0.50

资料来源：闪存市场官网，天风证券研究所

**嵌入式市场方面**，由于决策差异，原厂与移动终端在三季度的合约价格谈判进展不一，大多数仍在谨慎讨论中。同时，随着苹果 iPhone 16 的即将发布，行业期待其能提升消费者信心，刺激存储市场复苏。目前，嵌入式产品价格保持稳定。

图 18：eMMC 最新报价（当前价为美元）（09/03）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
eMMC 8GB 5.1	1.60	1.60	0.00% 0.00
eMMC 16GB 5.1	2.10	2.10	0.00% 0.00
eMMC 32GB 5.1	2.20	2.20	0.00% 0.00
eMMC 64GB 5.1	4.70	4.70	0.00% 0.00
eMMC 128GB 5.1	8.70	8.70	0.00% 0.00
eMMC 256GB 5.1	17.20	17.20	0.00% 0.00

资料来源：闪存市场官网，天风证券研究所

图 20：UFS 最新报价（当前价为美元）（09/03）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
UFS 2.2 64GB	5.20	5.20	0.00% 0.00
UFS 2.2 128GB	9.50	9.50	0.00% 0.00
UFS 2.2 256GB	18.60	18.60	0.00% 0.00
UFS 2.2 512GB	37.00	37.00	0.00% 0.00

资料来源：闪存市场官网，天风证券研究所

图 19：LPDDR 最新报价（当前价为美元）（09/03）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
LPDDR4X 96Gb	26.50	26.50	0.00% 0.00
LPDDR4X 64Gb	18.00	18.00	0.00% 0.00
LPDDR4X 48Gb	12.60	12.60	0.00% 0.00
LPDDR4X 32Gb	7.10	7.10	0.00% 0.00
LPDDR4X 16Gb	3.30	3.30	0.00% 0.00
LPDDR4X 8Gb	2.30	2.30	0.00% 0.00

资料来源：闪存市场官网，天风证券研究所

图 21：uMCP 最新报价（当前价为美元）（09/03）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
uMCP (LPDDR4X+UFS2.2) 4GB+128GB	16.40	16.40	0.00% 0.00
uMCP (LPDDR4X+UFS2.2) 6GB+128GB	21.00	21.00	0.00% 0.00
uMCP (LPDDR4X+UFS2.2) 8GB+128GB	26.00	26.00	0.00% 0.00
uMCP (LPDDR4X+UFS2.2) 8GB+256GB	35.20	35.20	0.00% 0.00

资料来源：闪存市场官网，天风证券研究所

图 22：eMCP 最新报价（当前价为美元）（09/03）

产品名称	本周价	上周价	涨跌
eMCP (eMMC+LPDDR4X) 64GB+32Gb	13.20	13.20	0.00% 0.00
eMCP (eMMC+LPDDR4X) 128GB+32Gb	16.40	16.40	0.00% 0.00
eMCP (eMMC+LPDDR4X) 128GB+48Gb	21.50	21.50	0.00% 0.00

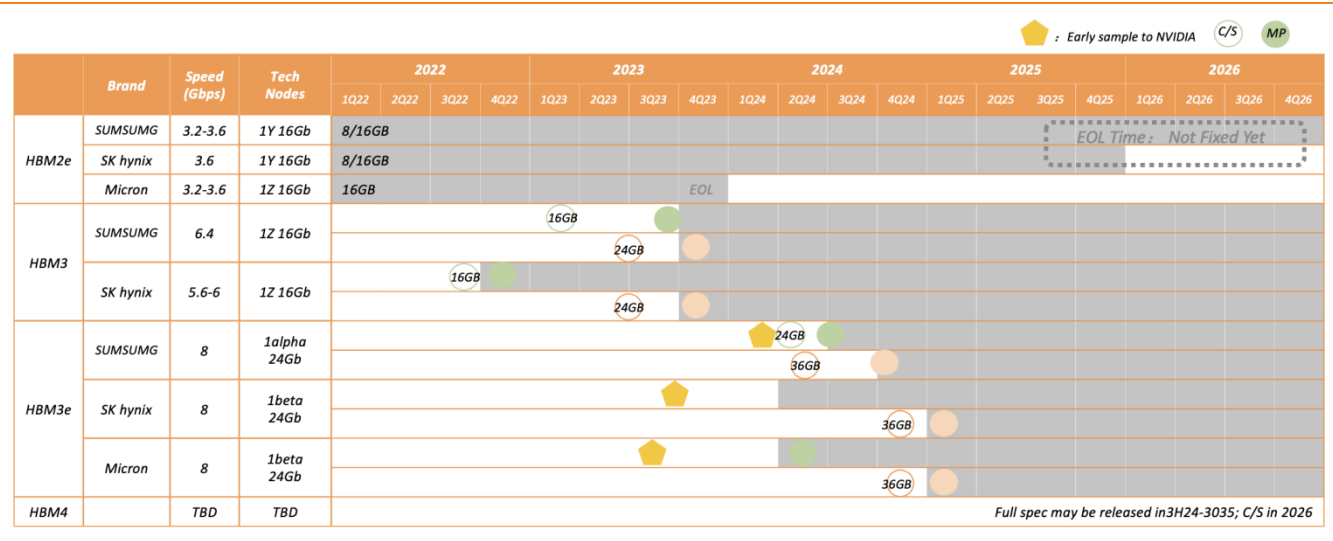
资料来源：闪存市场官网，天风证券研究所

**NVIDIA H200 发布催化 HBM 发展**：英伟达发布全新 H200 GPU 及更新后的 GH200 产品线。相比 H100，H200 首次搭载 HBM3e，运行大模型的综合性能提升 60%-90%。而新一代的 GH200 依旧采用 CPU+GPU 架构，也将为下一代 AI 超级计算机提供动力。HBM3E 是市场上最先进的高带宽内存 (HBM) 产品，HBM 即为高带宽内存 (High Bandwidth Memory)，是一种基于 3D 堆栈工艺的高性能 DRAM，通过增加带宽，扩展内存容量，让更大的模型，更多的参数留在离核心计算更近的地方，从而减少内存和存储解决方案带来的延迟、降低功耗。HBM 的高带宽相当于把通道拓宽，让数据可以快速流通。因此面对 AI 大模型千亿、万亿级别的参数，服务器中负责计算的 GPU 几乎必须搭载 HBM。英伟达创始人黄仁勋也曾表示，计算性能扩展的最大弱点是内存带宽，而 HBM 的应用打破了内存带宽及功耗瓶颈。在处理 Meta 的大语言模型 Llama2 (700 亿参数) 时，H200 的推理速度比 H100 提高了 2 倍，处理高性能计算的应用程序上有 20% 以上的提升，采用 HBM3e，完成了 1.4 倍内存带宽和 1.8 倍内存容量的升级。

**HBM 的制程发展**：目前市场上最新 HBM3E，即第 5 代 HBM，正搭载在英伟达的产品中。随着 AI 相关需求的增加，第六代高带宽存储器 HBM4 最早将于 2026 年开始量产。据韩媒报道，SK 海力士已开始招聘 CPU 和 GPU 等逻辑半导体设计人员。SK 海力士希望 HBM4

堆栈直接放置在 GPU 上，从而将存储器和逻辑半导体集成在同一芯片上。这不会改变逻辑和存储设备通常互连的方式，还会改变它们的制造方式。如果 SK 海力士成功，这可能会在很大程度上改变部分半导体代工的运作方式。

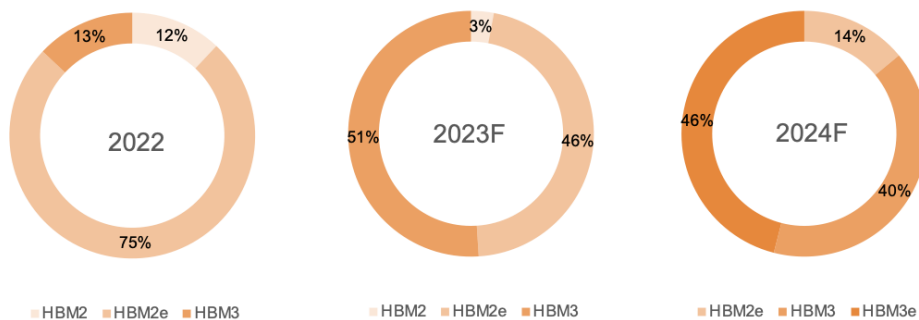
图 23：HBM 制程发展



资料来源：TrendForce，MTS2024 存储产业趋势研讨会，天风证券研究所

**HBM 迭代进程：**2024 年 HBM2、HBM2e 和 3e 的市场份额会发生比较明显的改变。2023 上半年主流还是 HBM2e，但是因为 H100 的问世，下半年 HBM3 就成为市场主流，很快 2024 年就会进行到 HBM3e，因为它堆叠的层数更高，所以平均单价一定要比现在再高 20%-30%以上，所以它对产值的贡献会更明显。

图 24：HBM 比重转进（依位元计算）



资料来源：TrendForce，MTS2024 存储产业趋势研讨会，天风证券研究所

**2024 年存储市场整体预判：**CFM 闪存市场数据显示，预计 2024 年存储市场规模相比去年将提升至少 42%以上。总产能上，NAND Flash 相比去年增长 20%，将超过 8000 亿 GB 当量，DRAM 预计增长达 15%，将达到 2370 亿 Gb 当量。在周期性波动的存储市场，回顾 2019-2023 这一轮周期变化，经历了供过于求、疫情、缺货、库存、超跌，最终以原厂主动减产结束，截止到去年的四季度原厂获利均有非常可观的改善，个别公司甚至已经开始恢复盈利。到今年的一季度经历再次大涨之后，CFM 闪存市场预计绝大部分公司的利润率都会得到全面有效的扭转，预计今年后续三个季度的价格将保持平稳向上的趋势。

**2024 年存储下游需求预判：**在 NAND 和 DRAM 应用中，手机、PC、服务器仍是主要产能出海口，消耗了 NAND、DRAM 超 80%产能。三大应用市场已经突破了下降期，CFM 闪存市场预计今年将实现温和增长。其中，预计手机今年将实现 4%的增长；PC 将实现 8%的增长；服务器将实现 4%的增长。随着前两年存储价格下调，单机容量增长明显，存储产品迎来价格甜蜜点。其中，UFS 在手机市场占有率进一步提升，高端机型已经基本上进入 512GB 以及 TB 时代，预计今年的手机平均容量将超过 200GB，在内存上也同样快速的朝更高性

能的 LPDDR5 演进，今年 CFM 闪存市场预计全年 DRAM 平均容量将超过 7GB。AI 手机将成为接下来手机的热点，将有力的推动手机存储再次升级。

**服务器市场：**2024 年是 DDR5 正式迈过 50% 的一年，同时 DDR5 平台第二代 CPU 都在今年发布，这会推动今年下半年 5600 速率会进入主流；同时高容量的模组 128GB/256GB 产品，因为 AI 大模型的出现，2023 年需求提升较多，但是受限 TSV 产能，供应有限。但 2024 年各家原厂都将推出 32Gb 单 die，使得 128GB 不需要做 TSV，这会为 128GB 模组进入服务器主流市场扫清最主要的障碍。此外 CXL 进入实用阶段，正式开始专利池的新时代，加上 HBM3e 进入量产，所以今年服务器内存有望迎来较大升级。Sever SSD 方面，为满足更高容量、更好性能的应用需求，2024 年 server PCIe5.0 SSD 的渗透率将较 2023 年翻倍成长，在容量上可以看到更多 8TB/16TB 及以上 PCIe SSD 在服务器市场上的应用增加。

**PC 市场：**尽管 2023 年整机需求下滑使得消费类 SSD 需求下滑，但是大容量 SSD 的应用显著提升，1TB PCIe4.0 已基本是 PC 市场的主流配置。在 PC DRAM 方面，由于更轻薄、长续航以及 LPCAMM 新形态产品在 PC 上的应用发展，CFM 闪存市场预计 LPDDR，尤其是 LPDDR5/X 将迎来迅速发展。随着新处理器平台的导入 DDR5 在 2024 年也将加大在 PC 上的应用。同时 Windows10 停止服务后，Windows 的更新也将会对 2024 年的 PC 销量有一定提振。**AI PC 预计在 2024 年全面推广**，与传统 PC 不同，AI PC 最重要的是嵌入了 AI 芯片，形成“CPU+GPU+NPU”的异构方案。可以支持本地化 AI 模型，所以需要更快的数据传输速度、更大的存储容量和带宽。

**Mobile 市场：**在移动领域，智能手机需求显示出复苏迹象，CFM 闪存市场预计 2024 年智能手机出货量将小幅增长。美光预计智能手机 OEM 将在 2024 年开始大量生产支持人工智能的智能手机，每台额外增加 4-8GB DRAM 容量。

**汽车和行业市场：**随着电动化趋势发展，智能汽车进入大模块化、中央集成化时代。ADAS 进入质变阶段，伴随着 L3 级及以上自动驾驶汽车在逐步落地，汽车对存储的性能和容量的要求也将急剧加大，单车存储容量将很快进入 TB 时代，另外在性能上、可靠性上汽车都会对存储提出越来越多的要求。CFM 闪存市场预计到 2030 年整个汽车市场规模将超过 150 亿美元。

**全年预期乐观，关注 DDR3 市场。**就当前原厂的订单及未来预期看，当前存储市场需求呈现逐步复苏态势，AI、汽车维持快速增长，消费类需求改善明显，2024 年全年发展预期维持乐观。从厂商发展重点看，随着行业供需关系大幅改善，存储原厂增加资本支出主要用于偏先进产品扩产。其中，SK 海力士 2024 年微弱增加资本支出并主要用于高价值产品扩产，计划 TSV 产能翻倍，扩大 256GB DDR5、16-24GB LPDDR5T 等供应，并拓展移动模组如 LPCAMM2 和 AI 服务器模组如 MCR DIMM 等产品矩阵；三星继续增加 HBM、1βnm DDR5、QLC SSD 等的供应。

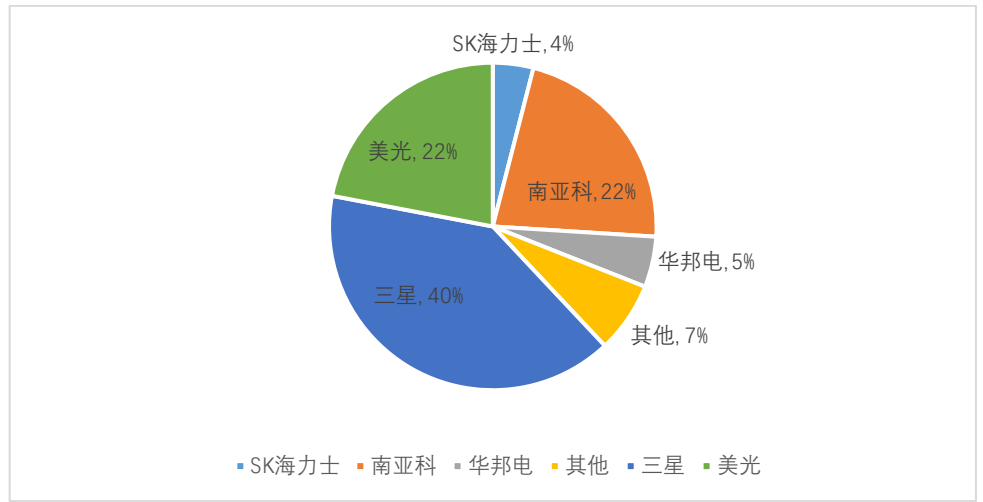
值得关注的是，近期三星、SK 海力士正加大对 HBM、DDR5 等高端产品投入，计划逐步退出 DDR3 等市场。作为 DDR3 主要供应商，产能调整对于终端供应及价格影响较大。

表 4：头部存储厂商减产 DDR3

国家/地区	厂商	DDR3 减产情况
韩国	三星	拟 2024Q2 底停产 DDR3
韩国	SK 海力士	将无锡厂 DDR3 产能转移至其他产品，或不再提供 DDR3
美国	美光	为扩大 DDR5、HBM 产能，大幅减少 DDR3 供应量
中国台湾	南亚科	产能开始大幅转向 DDR5，DDR3 仅接受客户代工订单

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

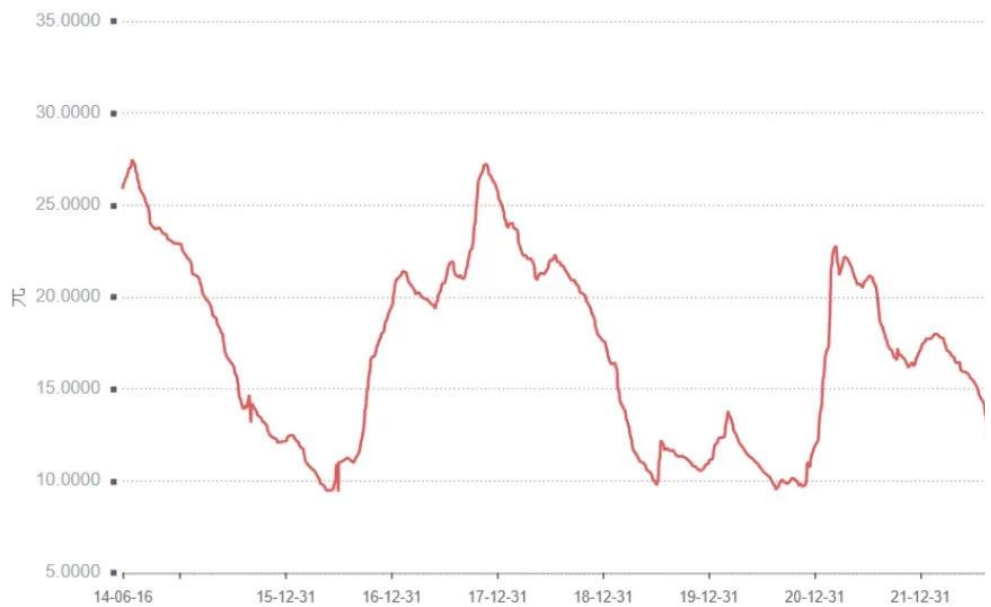
图 25：三星等厂商占 DDR3 市场主要份额



资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

目前 DDR3 等产品价格仍处于历史绝对底部，芯八哥认为，随着 DDR3 供应缩减，下半年涨价预期值得重点关注。

图 26: DDR3 价格走势图一览



资料来源：Wind，芯八哥公众号，天风证券研究所

长远看，随着三星、SK 海力士及美光等头部厂商加速扩产 HBM 等高端应用品类，国产厂商在 DDR3 等中低端市场替代潜力较大。从量产进展看，包括兆易创新及北京君正等均实现了规模出货，在 DDR3 产品性能比肩海外厂商，但料号数量方面仍有差距。

表 5: 部分国产 DDR3 量产厂商情况

厂商	量产产品	具体情况
兆易创新	DDR3L 2Gb、4Gb 等	2022 年推出的 DDR3L GDPxxxL M 系列产品，DDR3 在 2023 年规模量产入市，已基本覆盖网通、TV 等应用领域及主流客户群
北京君正	DDR3 等	DDR3 在 DRAM 产品中的占比约在 50% 左右，2024Q2 订单需求较大
江波龙	DDR3L 等	2020 年符合 JEDEC 标准 DDR3 产品量产，在海思、中兴微等多家平台完成主控端认证
东芯股份	DDR3 等	DDR3 产品具备高宽带、低延时的特点，已经在通讯设



## 备、移动终端等领域成熟应用

资料来源：各公司财报，芯八哥公众号，天风证券研究所

**CES2024-SK 海力士着重强调存储在 AI 时代发挥关键作用：**SK 海力士在拉斯维加斯举行的 CES2024 期间举行了题为“存储，人工智能的力量”的新闻发布会，SK 海力士社长兼 CEO 郭鲁正在会上阐述了 SK 海力士在人工智能时代的愿景。发布会上，郭社长表示，**随着生成人工智能的普及，存储的重要性将进一步提高。**他还表示，SK 海力士正在向 ICT 行业提供来自世界最佳技术的产品，引领“以存储为中心的人工智能无处不在”。郭社长在新闻发布会上提到：ICT 行业在 PC、移动和现在基于云的人工智能时代发生了较大的发展。在整个过程中，各种类型和大量的数据都在生成和传播。现在，我们进入了一个建立在所有数据基础上的 AGI 新时代。因此，新时代将朝着 AGI 不断生成数据并重复学习和进化的市场迈进。**在 AGI 时代，存储将在处理数据方面发挥关键作用。**从计算系统的角度来看，存储的作用甚至更为关键。以前，系统基本上是数据流从 CPU 到内存，然后以顺序的方式返回 CPU 的迭代，但这种结构不适合处理通过人工智能生成的海量数据。现在，人工智能系统正在以并行方式连接大量人工智能芯片和存储器，以加速大规模数据处理。这意味着人工智能系统的性能取决于更强更快的存储。**人工智能时代的存储方向应该是以最快的速度、最有效的方式和更大的容量处理数据。**这与过去一个世纪的存储开发一致，后者提高了密度、速度和带宽。

**2024 年第三季度价格预判：1)NAND：**第三季除了企业端持续投资服务器建设，尤其 Enterprise SSD 受惠 AI 扩大采用，继续受到订单推动，消费性电子需求持续不振，加上原厂下半年增产幅度趋于积极，第三季 NAND Flash 供过于求比例(Sufficiency Ratio)上升至 2.3%，NAND Flash 均价(Blended Price)涨幅收敛至季增 5-10%。**2)DRAM：**由于通用型服务器(general server)需求复苏，加上 DRAM 供应商 HBM 生产比重进一步拉高，使供应商将延续涨价态度，第三季 DRAM 均价将持续上扬。DRAM 价格涨幅达 8~13%，其中 Conventional DRAM 涨幅为 5-10%，较第二季涨幅略有收缩。

图 27：24Q2-24Q3 NAND FLASH 产品合约价涨跌幅预测

	2Q24 (E)	3Q24 (F)
Client SSD	up 20~25%	up 3~8%
Enterprise SSD	up 20~25%	up 15~20%
eMMC UFS	consumer: up 0~5% mobile: up 10~15%	consumer: mostly flat mobile: up 3~8%
3D NAND Wafers (TLC & QLC)	up 5~10%	mostly flat
Total NAND Flash	up 15~20%	up 5~10%

图 28：24Q2-24Q3 DRAM 产品合约价涨跌幅预测

	2Q24 (E)	3Q24 (F)
PC DRAM	DDR4: up 15~20% DDR5: up 15~20% Blended: up 15~20%	DDR4: up 3~8% DDR5: up 3~8% Blended: up 3~8%
Server DRAM	DDR4: up 15~20% DDR5: up 15~20% Blended: up 15~20%	DDR4: up 5~10% DDR5: up 8~13% Blended: up 8~13%
Mobile DRAM	up 5~10%	up 3~8%
Graphics DRAM	up 3~8%	up 3~8%
Consumer DRAM	DDR3: up 3~8% DDR4: up 5~10%	up 3~8%
Total DRAM	up 13~18% (HBM Penetration: 4%)	Conventional DRAM: up 5~10% HBM Blended: up 8~13% (HBM Penetration: 6%)

资料来源：集邦存储市场公众号，天风证券研究所

资料来源：集邦存储市场公众号，天风证券研究所

## 4.2. 代工：整体代工产能及订单有所复苏，部分代工价格或上涨

TrendForce 集邦咨询研究显示，2023 年第四季全球前十大晶圆代工业者营收季增 7.9%，**达 304.9 亿美元，环比增长 7.9%，回暖迹象明显。**主要受惠于智能手机零部件拉货动能延续，包含中低端 Smartphone AP 与周边 PMIC，以及 Apple 新机出货旺季，带动 A17 主芯片、周边 IC 如 OLED DDI、CIS、PMIC 等零部件。其中，台积电 (TSMC) 3nm 高价制程贡献营收比重大幅提升，推升台积电第四季全球市占率突破六成。

表 6：23Q4 全球前十晶圆代工业绩及市场份额变化情况

排名	厂商名称	市场份额	4Q2023(百 万美元)	3Q2023(百 万美元)	环比增长
1	台积电(TSMC)	61.2%	19,660	17,249	14.0%
2	三星(Samsung)	11.3%	3,619	3,690	-1.9%
3	格芯(GlobalFoundries)	5.8%	1,854	1,852	0.1%

4	联电(UMC)	5.4%	1,727	1,801	-4.1%
5	中芯国际(SMIC)	5.2%	1,678	1,620	3.6%
6	华虹集团 (Huahong Group)	2.0%	657	766	-14.2%
7	高塔半导体(Tower)	1.1%	352	358	-1.7%
8	力积电(PSMC)	1.0%	330	305	8.0%
9	合肥晶合(Nexchip)	1.0%	308	283	9.1%
10	世界先进(VIS)	1.0%	304	333	-8.7%
	合计	95.0%	30,489	28,258	7.9%

资料来源: TrendForce 集邦咨询公众号, 天风证券研究所

TrendForce 集邦咨询表示, 2023 年受供应链库存高企、全球经济疲弱, 以及市场复苏缓慢影响, 晶圆代工产业处于下行周期, 前十大晶圆代工营收年减约 13.6%, 来到 1,115.4 亿美元。2024 年在 AI 相关需求的带动下, 营收预估有机会年增 12%, 达 1,252.4 亿美元, 而台积电受惠于先进制程订单稳健, 年增率将大幅优于产业平均。

**表 7: 全球晶圆代工厂对未来行情的看法**

公司名称	对未来行情的主要看法
台积电	2024 年将是实现健康增长的一年, 目前已经看到智能手机需求出现企稳回暖的初步信号, 但在未来 2-3 年, 智能手机增速仍低于企业平均水平; 汽车业务方面, 台积电指出, 过去三年汽车需求非常强劲, 不过从 2023 年下半年开始, 汽车已经进入库存调整模式。
联电	联电共同总经理王石认为第四季度 PC 与手机需求会与第三季度相当, 两大应用领域近期有急单出现, 研判这是早期显示库存修正到一定程度的迹象, 但有些应用的库存修正会延续到明年。另外, 车用客户自 2022 年开始累积的高库存, 有望在第四季度消化至一定水位。
力积电	力积电总经理谢再居称, 目前有感受到供应链库存降到合理水位, 并观察到包括手机用驱动 IC, 以及监视系统采用的 CMOS 图像传感器 (CIS) 都有短单的需求, 部分订单能见度甚至超过一个季度; 另外, 特殊存储产品单价也展现回升态势, 正向看待第四季度业绩表现。
世界先进	世界先进的展望则较为保守, 该公司预期第四季度半导体供应链谨慎控管库存, 虽然消费电子库存调整接近尾声; 但车用与工业较晚修正库存, 预期第四季度仍有明显修正, 估计第四季度晶圆出货量季减 8%至 10%, 产品平均销售单价 (ASP) 估季减 2%内, 毛利率将持续下滑到 22%至 24%。
三星	三星晶圆代工事业也受益于先进制程、高中低阶 5G APSoC、5G modem 及成熟制程 28nm OLED DDI 等订单加持, 推动其第三季度营收环比增长 14.1%至 36.9 亿美元。
格芯	格芯 Q1 和 Q2 产能利用率从 85%上升至 88%, 由于格芯能承接来自美国航天、国防、医疗等特殊领域芯片代工, 及车用相关订单与客户签订长约 (LTA) 而较为稳定, 有效支撑格芯产能利用率。格芯 CEO ThomasCaulfield 在财报中表示, 虽然全球经济及地缘政治仍充满不确定性, 我们持续与客户密切合作, 协助客户去化库存。
英特尔	受益于下半年笔记本电脑拉货季节性因素, 加上拥有先进制程, 英特尔 IFS 第三季营收环比增长 34.1%至约 3.1 亿美元, 市场份额为 1%, 自 Intel 财务拆分后排名首次进入全球前十
高塔半导体	高塔半导体受益于季节性因素, 智能手机、车用/工控领域半导体需求相对稳定, 第三季营收约 3.6 亿美元, 大致与第二季持平, 微幅增长 0.3%, 市场份额为 1.2%
中芯国际	中芯国际联席 CEO 赵海军表示, 在手机消费和工业控制领域, 中国客户基本上达到了进出平衡的库存水平。但欧美客户依然处于历史高位。其次, 汽车产品的相关库存开始偏高, 正在引起客户对市场修正的警觉, 下单开始迅速收紧。还有, 三季度手机终端市场出现回暖迹象, 整体行业认为明年整体消费电子会有回暖行情。
华虹公司	展望 2023 年第四季度, 华虹半导体预计销售收入约在 4.5 亿美元至 5.0 亿美元之间, 预计毛利率约在 2%至 5% 之间。产能方面, 截至第三季度末, 华虹半导体折合 8 英寸晶圆月产能增加至 35.8 万片, 总体产能利用率为 86.8%。

资料来源: 芯八哥公众号, 天风证券研究所

**8 月, 先进制程和部分特色工艺产能和价格逐步回升, 成熟制程价格触底回升明显。**

**图 29: 主要晶圆代工厂动态**

厂商	8月产能利用率	8月动态	9月价格趋势
台积电	>90%	2025年量产2nm芯片;AI和HPC代工需求保持高增长	上升
三星	85%-90%	暂停平泽P4厂代工产线建设;预计2024H2移动需求将反弹, AI/HPC应用需求将继续保持高增长	稳定
联电	70%	2024Q3稼动率提升, ASP稳定;车用需求仍不振, 库存或2025Q1恢复健康水平	稳定
中芯国际	90%-100%	预计2024Q3价格环比增长, 趋势延续到Q4;展望下半年汽车和工业需求尚未反弹	上升
格芯	70%-75%	2024Q2手机、汽车和工业订单需求下降	稳定
世界先进	65-70%	车用等部分终端产品持续库存调整;对终端需求看法仍保守	下降
力积电	60%-70%	下游客户库存健康, 第三季度下单能见度稳定	下降
华虹	>95%	预计2024H2至2025年超95%产能利用率, ASP逐季上涨	上升

资料来源: 芯八哥公众号, 天风证券研究所

### 4.3. 封测: AI、高端消费电子等先进封测需求快速增长, 产能利用率快速回升

8月, AI、高端消费电子等先进封测需求快速增长, 产能利用率快速回升。日月光斥资新台币 52.63 亿元扩充先进封装(高端消费电子、AI 等) 产能; 台积电表示目前 AI 封测订单供不应求; 长电科技表示 2024Q2 各下游环比均双位数增长; 通富微电表示 2024H1 产能利用率提升, 营收增幅明显; 华天科技表示 2024H1 订单增加, 产能利用率提高。

图 30: 主要封测厂商动态

厂商	8月产能利用率	8月动态	8月订单预测
日月光	70%-85%	斥资新台币52.63亿元扩充先进封装(高端消费电子、AI等) 产能	上升
台积电	100%	目前AI封测订单供不应求	上升
长电科技	70%-85%	2024Q2各下游环比均双位数增长	上升
通富微电	80%-90%	2024H1产能利用率提升, 营收增幅明显	上升
华天科技	80%-90%	2024H1订单增加, 产能利用率提高	上升
中小封测厂	60%-70%	订单有上升, 价格低位	稳定

资料来源: 芯八哥公众号, 天风证券研究所

AI 需求全面提升, 带动先进封装需求提升, 台积电启动 CoWoS 大扩产计划。今年一季度以来, 市场对 AI 服务器的需求不断增长, 加上 Nvidia 的强劲财报, 造成台积电的 CoWoS 封装成为热门话题。据悉, Nvidia、博通、谷歌、亚马逊、NEC、AMD、赛灵思、

Habana 等公司已广泛采用 CoWoS 技术。台积电董事长刘德音在今年股东大会上表示，最近因为 AI 需求增加，有很多订单来到台积电，且都需要先进封装，这个需求远大于现在的产能，迫使公司要急遽增加先进封装产能。

**Chiplet/先进封装技术有望带动封测产业价值量提升，先进封装未来市场空间广阔。**据 Yole 分析，先进封装 (AP) 收入预计将从 2022 年的 443 亿美元增长到 2028 年的 786 亿美元，年复合增长率为 10%。在封装领域，2.5D、3D Chiplet 中高速互联封装连接及 TSV 等提升封装价值量，我们预测有望较传统封装提升双倍以上价值量，带来较高产业弹性。

**封测大厂来看 23H1 业绩环比改善，24Q1 同比高增。**根据头部封测公司 23Q3、Q4 报告，可以发现各公司营收均有环比改善，归母净利润环比改善或跌幅收窄，整体呈缓慢复苏态势。24Q1 营收业绩因制造周期环比下降，但下降幅度较 23Q1 相对较小，同比营收与归母净利润依然有所上升。

图 31：主要封测企业 23Q4 业绩（营收、归母净利润）环比继续改善（%）（环比数据）

		22Q1	22Q2	22Q3	22Q4	23Q1	23Q2	23Q3	23Q4	24Q1
长电科技	营收	-5.21%	-8.39%	23.19%	-2.18%	-34.77%	7.72%	30.80%	11.80%	-25.83%
	归母净利润	2.17%	-20.82%	33.27%	-14.34%	-85.83%	250.83%	23.96%	3.97%	-72.79%
通富微电	营收	-2.32%	12.52%	13.55%	6.21%	-24.02%	13.45%	13.91%	6.06%	-16.98%
	归母净利润	-35.05%	21.87%	-44.53%	-77.32%	-81.97%	-4323.89%	-164.52%	87.95%	-57.75%
华天科技	营收	-6.88%	6.83%	-9.56%	-4.36%	-19.44%	27.29%	4.55%	8.40%	-3.83%
	归母净利润	-46.65%	48.52%	-38.06%	-73.93%	-314.45%	-259.11%	-88.19%	617.49%	-60.24%

资料来源：Wind，天风证券研究所

部分封测厂产能利用率回到较高水平，金属价格上涨或带动封测涨价。一季度受到华为手机对国产芯片供应链的拉动，以及 AI 等的需求增长，部分封测厂（如华天/甬矽等）产能利用率回到较高水位，淡季不淡，超出市场预期。近期金属价格上涨，封测成本端预计有所提升，加之下半年产业链进入传统旺季，我们预计封测价格有提升的动力，建议关注产业链相关公司的投资机遇。

#### 4.4. 设备材料零部件：7 月，可统计设备中标数量 70 台，招标数量 118 台 8 月，半导体设备订单增长稳定；材料订单疲软，下游客户库存较高。

图 32：半导体设备及硅晶圆头部企业情况

类型	企业	8月订单	8月库存	9月订单预测
设备	ASML	稳定	低	稳定
	AMAT	稳定	低	稳定
	泛林	稳定	低	稳定
	TEL	稳定	低	稳定
	科磊	稳定	低	稳定
	北方华创	上升	低	上升
	中微公司	上升	低	上升
硅晶圆	信越化学	下降	一般	下降
	Sumco (胜高)	下降	一般	下降
	环球晶圆	下降	较高	下降
	台胜科技	下降	较高	下降
	合晶科技	下降	较高	下降
	沪硅产业	上升	一般	上升

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

#### 4.4.1. 设备及零部件中标情况：7 月可统计设备中标数量 70 台，国内零部件中标数量同比+200%

2024 年 7 月可统计中标设备数量共计 70 台，同比-97.15%。其中辅助设备 1 台，检测设备 64 台，刻蚀设备 1 台，其他设备 1 台，热处理设备 1 台，溅射设备 1 台，薄膜沉积设备 1 台。

图 33：2024 年 7 月部分国内企业可统计中标情况（台）

中标企业	薄膜沉积设备	检测设备	刻蚀设备	其他	溅射设备	热处理设备	辅助设备	总计
北方华创		1		1		1	1	4
武汉精测			64		1			65
上海正帆科技股份有限公司							1	1
总计	1	1	64	1	1	1	1	70

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

2024年7月，北方华创可统计中标设备4台，同比-42.86%，包括1台刻蚀设备，1台热处理设备，1台薄膜沉积设备，1台溅射设备

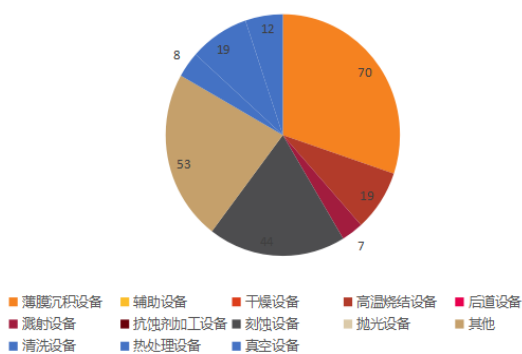
图 34：2020-2024.7 北方华创可统计中标情况（台）

年份	薄膜沉积设备	辅助设备	干燥设备	高温烧结设备	后道设备	溅射设备	抗蚀剂加工设备	刻蚀设备	抛光设备	其他	清洗设备	热处理设备	真空设备	总计
2020年	27	26	3			34	6	26	9	3	10	41	5	190
1月	18							3						18
2月		2												2
3月														
4月	1		2			34	1				4	2		40
5月														
6月	1							1					2	3
7月	4	24						3				18	2	24
8月														
9月								1						1
10月	2			1				1				4		40
11月														
12月														
2021年	28	1		3		3		42		17	21	28	17	165
1月														
2月														
3月	1													1
4月	1													1
5月								1						1
6月								15		8	7	16		57
7月														
8月	4							1			2			4
9月								3						3
10月	2							1						3
11月														
12月	7	1						1						8
2022年	16	34		8	1	5		66		19	14	14	7	190
1月														
2月	1							2						1
3月	1													1
4月	1													1
5月														
6月	1	20						4		8	4			57
7月														
8月		12						1						16
9月		1												2
10月														
11月														
12月	7													7
2023年	70			19		7		60		53	8	19	12	232
1月														
2月	1													1
3月														
4月														
5月														
6月														
7月														
8月														
9月														
10月														
11月														
12月	7													7
2024年	8	0	0	0	0	3		16		5	4	21	0	56
1月														
2月														
3月														
4月														
5月														
6月														
7月	1	0	0	0	0	1								1
8月														
9月														
10月														
11月														
12月														

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

图 35：2023 年北方华创各主要设备类型中标分布情况（台）

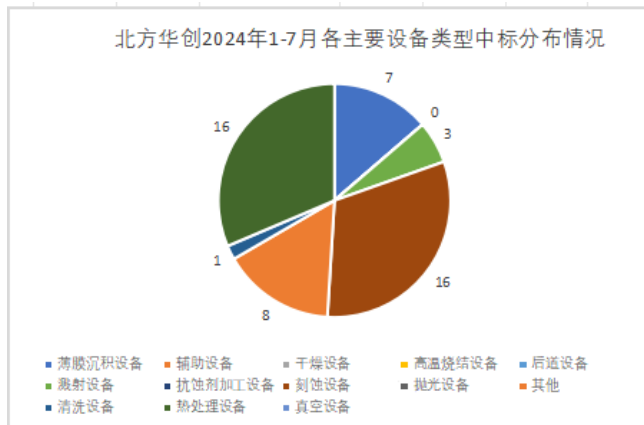
北方华创2023年各主要设备类型中标分布情况



资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

图 36：2024 年 1-7 月北方华创各主要设备类型中标分布情况（台）

北方华创2024年1-7月各主要设备类型中标分布情况



资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

2024年7月，国内半导体零部件可统计中标共11项，同比+138%。主要为电气类9项，为北方华创、英杰电气中标，气液/真空系统类1项，为北方华创中标。

图 37：2011-2024.7 国内半导体设备零部件可统计中标情况（台）

计数项-零部件类型	列标签	电气类	光学类	机电一体类	机械类	气液/真空系统类	仪器仪表类	总计
北方华创		80			1		3	84
2021年							1	1
2022年		1					1	2
2023年		47						47
2024年		32			1		1	34
北方华创旗下七星流量计								1
2023年								1
北广科技		6						6
2013年		1						1
2016年		1						1
2020年		1						1
2021年		3						3
北京北方华创真空技术有限公司		6					3	9
2023年		3					2	5
2024年		3					1	4
菲利华 (湖北)			1		21		2	24
2018年					1			1
2020年			1		2		1	4
2021年					6			6
2022年					6			6
2023年					3			3
2024年					3		1	4
菲利华 (上海)							4	4
2022年							3	3
2023年							1	1
富创精密							2	2
2021年							1	1
2022年					1		1	2
汉钟精机		3			55		7	65
2019年							1	1
2021年							1	1
2022年		1			5		1	7
2023年		2			37		1	40
2024年					13		3	16
华卓精科		1			7	1		9
2022年					3			3
2023年		1			3	1		5
2024年					1			1
英杰电气		144	1		3		1	149
2011年		2						2
2013年		1						1
2014年		1						1
2015年		7						7
2016年		3						3
2017年		3						3
2018年		7						7
2019年		9					1	10
2020年		10	1					11
2021年		18						18
2022年		20						20
2023年		31			3			34
2024年		32						32
中国科学院微电子研究所		4						4
2019年		1						1
2020年		1						1
2023年		1						1
2024年		1						1
总计		244	2	62	31		18	358

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

2024年7月，国外半导体零部件可统计中标共15项，同比+150%。主要为电气类8项、光学类4项，机电一体类1项，气液/真空系统类2项。分公司来看，蔡司可统计中标零部件最多，为4项，Brooks 2项，MKS 2项，Advanced Energy 2项，Inficon 3项，VAT 1项，Ferrotec 1项。

图 38：2011-2024.7 国外半导体设备零部件可统计中标情况（台）

行标签	列标	电气类	光学类	机电一体类	机械类	气液/真空系统	气液/真空系统类(空白)	总计
Advanced Energy		16						16
2015年		1						1
2017年		2						2
2018年		3						3
2019年		1						1
2020年		3						3
2021年		3						3
2022年		1						1
2024年		2						2
Brooks		1				23		26
2014年		1		2				1
2017年				1			1	2
2018年							1	1
2019年							5	5
2021年							4	4
2022年							7	7
2023年							3	3
2024年		1					2	3
Cymer			2					2
2017年			1					1
2018年			1					1
EBARA					1		38	39
2014年							4	4
2018年							3	3
2019年							4	4
2020年							2	2
2021年					1		7	8
2022年							5	5
2023年							7	7
2024年							6	6
Elliott Ebara Singapore							28	28
2019年							1	1
2022年							4	4
2023年							12	12
2024年							11	11
Ferrotec		1		2				3
2021年				1				1
2022年				1				1
2024年		1						1
Inficon		1	1	1	1	1	48	53
2018年							1	1
2019年							1	1
2021年					1			1
2022年							5	5
2023年			1				36	37
2024年		1		1		1	5	8
MKS		18	7		10		39	74
2012年							1	1
2015年							3	3
2017年		2					7	9
2018年							6	5
2019年		2					7	9
2020年			1				3	4
2021年		5					8	13
2022年		3						3
2023年		2	3				5	10
2024年		4	3		10			17
MKS、Inficon							1	1
2018年							1	1
MKS、VAT							1	1
2020年							1	1
Newport		2	97		28		1	129
2022年		1	8				1	10
2023年			72		19			91
2024年		1	17		9			27
Pfeiffer							160	160
2015年							5	5
2016年							5	5
2017年							4	4
2018年							8	8
2019年							7	7
2020年							21	21
2021年							19	19
2022年							26	26
2023年							44	44
2024年							21	21
Pfeiffer、VAT							2	2
2020年							2	2
VAT		1					32	33
2011年							1	1
2017年							1	1
2018年							3	3
2019年							2	2
2020年							1	1
2021年							1	1
2022年							5	5
2023年							9	9
2024年		1					9	10
蔡司		2	193				3	198
2017年							2	2
2019年		1	3					4
2020年			6					6
2021年			4					4
2022年			37				2	39
2023年			94					94
2024年		1	47				1	49
(空白)								
<2011/11/9								
总计		42	300	5	40	1	376	764

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

#### 4.4.2. 设备招标情况：7月可统计设备招标数量 118 台，同比下降 14.49%

2024 年 7 月可统计中标设备数量共计 118 台，同比-14.49%。其中辅助设备 24 台，检测设备 5 台，真空设备 57 台，后道设备 6 台。

图 39：2024 年 7 月部分国内企业可统计招标情况（台）

求和项:设备列标签	辅助设备	后道设备	检测设备	其他	真空设备	总计
华润微集成电路 (无锡)				3	24	27
上海积塔半	24	6	2	2		57
<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>26</b>		<b>118</b>

资料来源: 千里马招标网, 天风证券研究所 注: 统计数据或不完善, 具体以各公司官方披露为准

2024年7月, 华虹宏力无可统计招标设备。

2020-2024年7月, 华虹宏力可统计招标设备共 3592 台, 包括 246 台薄膜沉积设备、395 台辅助设备、56 台光刻设备、69 台后道设备、305 台检测设备、2 台溅射设备、34 台抗蚀剂加工设备、152 台刻蚀设备、33 台离子注入设备、45 台抛光设备、1523 台其他设备、140 台清洗设备、388 台热处理设备、204 台真空设备。

图 40: 2020-2024.7 华虹宏力可统计招标情况 (台)

2020年	薄膜沉积设备	辅助设备	光刻设备	后道设备	检测设备	溅射设备	抗蚀剂加工设备	刻蚀设备	离子注入设备	抛光设备	其他	清洗设备	热处理设备	真空设备	总计
1月	122	90	20	5	147		6	56							2128
2月															8
3月															1957
4月															371
5月															172
6月															12
7月															25
8月															12
9月															36
10月															6
11月															66
12月															21
2021年	101	240	10	26	16	2	5	62	12	17	173	38	248	950	
1月															348
2月															3
3月															6
4月															10
5月															6
6月															14
7月															211
8月															8
9月															3
10月															2
11月															2
12月															334
2022年	13	52	5	10	106		2	20	1	1	11	9	57	287	
1月															88
2月															8
3月															31
4月															38
5月															48
6月															0
7月															4
8月															6
9月															20
10月															1
11月															5
12月															36
2023年	10	13	21	28	35		21	14		7	17	16	31	11	224
1月															16
2月															28
3月															6
4月															1
5月															6
6月															0
7月															136
8月															9
9月															4
10月															14
11月															3
12月															3
2024年															3
1月															0
2月															0
3月															0
4月															2
5月															1
6月															0
7月															0

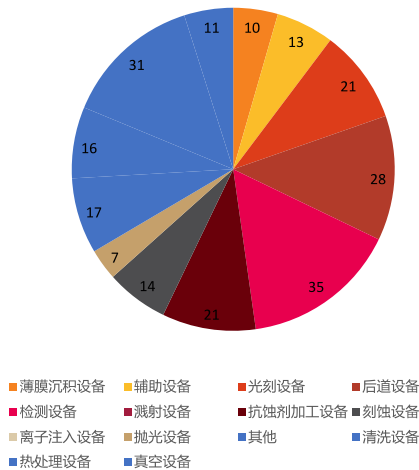
资料来源: 千里马招标网, 天风证券研究所 注: 统计数据或不完善, 具体以各公司官方披露为准

图 41: 2023 年华虹宏力各主要设备类型中标分布情况 (台)

图 42: 2024 年 1-7 月华虹宏力各主要设备类型中标分布情况 (台)

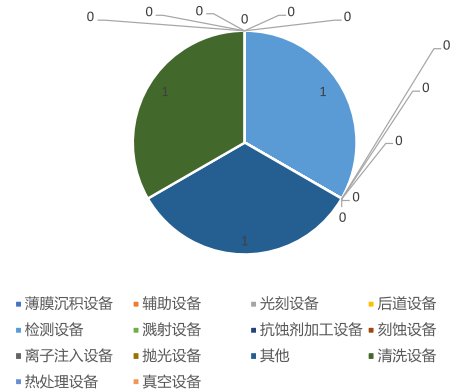


华虹华力2023年主要设备类型招标分布



资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

华虹华力2024年主要设备类型招标分布



资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

#### 4.5. 分销商：分化态势明显，中国为代表的亚太地区市场快速回升，主要品类价格逐步企稳

8月，头部分销商分化态势明显，中国为代表的亚太地区市场快速回升，主要品类价格逐步企稳。

图 43：主要元器件分销商最新动态

厂商	24年8月动态
大联大	AI及PC回温下元器件需求增长
文晔科技	下半年手机、PC等消费型迎来消费旺季
中电港	2024H1营收247.17亿元，同比上升57.45%
香农芯创	2024H1市场需求提升，产品销售价格上涨
英唐智控	车载DDIC已进入批量订单交付阶段
力源信息	2024H1营收34.34亿元，同比增长32.33%
艾睿电子	欧美市场需求疲软，中国需求增长和价格稳定；汽车和更广泛的工业市场仍然疲软；下半年订单改善，需求回升
安富利	下半年相对上半年有增长，电子元器件业务在全球范围内下降但是亚洲地区触底明显
商络电子	2024H1终端需求的回暖使得量价以及库存回归合理水平

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

### 5. 终端应用：看好消费电子复苏，关注元宇宙发展走势

#### 5.1. 消费电子：全球智能手机及 PC 等消费类需求维持弱势复苏，AI+相关应用增长较快，XR 需求增长持续低迷

业内机构普遍看好 2024 年的行情。其中，在手机领域，根据 IDC 预测，2023 年全球智能手机出货量将同比下降 1.1%至 11.9 亿部，2024 年全球智能手机出货量将同比增长 4.2%至 12.4 亿部；在折叠手机领域，根据 Counterpoint，2023 年全球折叠屏智能手机出货量预计将同比增长 52%达 2270 万部，预计在 2024 年进入折叠屏手机的快速普及期，2025 年将达 5500 万部；在 PC 领域，根据 IDC 的数据，23Q3 全球 PC 出货量为 6820 万台，环比增长 11%，出货量已经连续两个季度环比增长。据其预测，PC 销量在 2023 年急剧下降 14%后，在 2024 年将增长 4%；而在笔电领域，据 TrendForce 的数据，2023 年三季度，全球笔记本出货量已经连续两个季度实现环比增长。据其预测，2024 年全球笔记本市场整体出货规模将达 1.72 亿台，年增 3.2%。

表 8：业内机构普遍看好 2024 年消费电子行业的发展

主要品类	预测情况
手机	根据 IDC 预测,2023 年全球智能手机出货量将同比下降 1.1%至 11.9 亿部,2024 年全球智能手机出货量将同比增长 4.2%至 12.4 亿部。
折叠手机	根据 Counterpoint, 2023 年全球折叠屏智能手机出货量预计将同比增长 52% 达 2270 万部, 预计将在 2024 年开始进入折叠屏手机的快速普及期, 2025 年将达 5500 万部。
PC	根据 IDC 的数据, 23Q3 全球 PC 出货量为 6820 万台, 环比增长 11%, 同比降幅收窄至 8%, PC 出货量连续两个季度环比增长, 市场出现好转迹象。IDC 预计 PC 销量在 2023 年急剧下降 14%后, 在 2024 年将增长 4%
笔电	据 TrendForce 的数据, 2023 年三季度, 全球笔记本出货量实现连续两个季度的环比增长, 同比降幅持续收窄。据其预测, 2024 年全球笔记本市场整体出货规模将达 1.72 亿台, 年增 3.2%。

资料来源: 芯八哥公众号, 天风证券研究所

8 月, 全球智能手机及 PC 等消费类需求维持弱势复苏, AI+ 相关应用增长较快, XR 需求增长持续低迷。

表 9: 消费电子厂商最新动态

类别	企业	8 月动态
智能手机	苹果	今年新机备货量超 9500 万部
	三星	预计 2024H2 AI+下 PC 和手机需求上升
	华为	2024H1 公司以 17.5%份额成中国智能手机市场出货第一
	vivo	计划到 2026 年每年出货 1 亿部手机
	小米	2024Q2 在中东市场成长近 70%
	传音	公司产能还是以国内为主; 2023Q3 以来存储价格波动较大
PC	联想	2024Q2 PC 平均售价同比上涨;同时在 AIPC 方面市场反馈良好
	宏碁	计划扩大 AI PC 出货量, 2025 年份额将达到 40%
	戴尔	2024Q2 客户解决方案集团(CSG)营收 124 亿美元, 同比下滑 4%;预计下半年 PC 更新周期和 AI 的长期影响将为 PC 市场带来顺风
	惠普	2024Q2 消费类电脑营收下降 1%, 商用电脑营收增长 8%;计划将 50%以上 PC 产能迁出中国
VR/AR	Meta	被曝停止开发高端混合现实头显
	歌尔股份	2024H1 智能硬件营收同比降超 3 成
	苹果	将 Vision Pro 今年销量预期从 70 万-80 万部下调至 40 万-45 万部
无人机	大疆	2024H1 农业无人机保有量超 30 万台;积极布局 Ebike(电动助力自行车)市场

资料来源: 芯八哥公众号, 天风证券研究所

## 5.2. 新能源汽车: 汽车需求分化, 市场竞争加剧, 谨慎评估最新各国电车政策对于国产电车及供应链冲击。

8 月, 汽车需求分化, 市场竞争加剧, 谨慎评估最新各国电车政策对于国产电车及供应链冲击。

表 10: 新能源汽车厂商最新动态

厂商	8月动态
比亚迪	Q2销量超本田、日产，跃居世界第7；欧盟最终裁决将对比亚迪征收17%额外关税；郑州工厂大幅扩招5000人
特斯拉	取消泰国建厂计划；预计中国市场Q3销量创新高
本田	2024年1-7月广汽本田产量达35.27万辆，同比下降35.41%
大众	缩减欧洲和北美电池工厂计划
宝马	计划未来几年内制造并销售量产燃料电池汽车；7月欧洲电动车销量首超特斯拉
奔驰	重心放在了单车毛利率更高的高端车型上
丰田	7月受中国和泰国等市场产量下滑影响，全球产量连续第六个月出现下降
福特	放缓电动汽车计划
Stellantis	上半年净利润同比下降48%，或进一步裁员
广汽埃安	8月全球销量35355辆，居主流纯电前三
吉利	2024H1三电业务、技术授权及研发服务收入等营收增长至198.25亿元
奇瑞	2024年1-8月新能源汽车累计销量272847辆，同比增长187%
理想	累计交付量突破90万辆
长城	在海外市场的认可度仍在快速提升
小米	2024Q2智能电动汽车收入62亿元，单车亏损超6万
赛力斯	115亿元购买深圳引望10%股权
蔚来	8月交付新车20176台，交付量连续四个月超2万
小鹏	未来10年中国汽车主流品牌将只剩7家；计划在欧洲生产汽车以避免关税

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

### 5.3. 工控：工控订单增长低于预期，库存去化持续但仍处较高水平

8月，工控订单增长低于预期，库存去化持续但仍处较高水平。

表 11：工控厂商最新动态

厂商	8月动态
西门子	自动化业务连续下滑，库存水平仍然较高
ABB	积极加速对中国汽车相关自动化市场布局
台达电	2024Q2工业相关业务实现环比增长
罗克韦尔	经销商和机器制造商的库存消耗有所进展但2024Q3订单环比增长将低于预期
汇川技术	2024H1通用自动化业务实现销售收入约75亿元，同比增长约10%
雷赛智能	2024H1伺服、控制系统业务稳中有升，PLC产品快速放量
禾川科技	光伏、锂电处于行业低谷期；受光伏行业的影响，预计公司全年收入、净利润将会承压
埃斯顿	受光伏行业需求疲软叠加重型工业需求下降影响；2024H1公司工业机器人相关业务下滑
中控技术	2024H1工业自动化及智能制造相关产品景气度较好海外订单高增
新时达	2024H1电梯厂商降价压力及利润压力下探传导至部件厂商
华中数控	2024H1机床行业需求承压，公司数控系统与机床业务略增
信捷电气	2024Q2增速环比Q1显著提升，PLC国内需求快速增长

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

### 5.4. 光伏：光伏行业竞争加剧，价格持续承压，欧洲市场库存仍较高

8月，光伏行业竞争加剧，价格持续承压，欧洲市场库存仍较高

表 12：光伏厂商最新动态

厂商	8 月动态
阳光电源	2024H1 光伏逆变器营收同比增长 12.6%，预计逆变器毛利率未来有望保持稳定
天合光能	2024H1 光伏产业链竞争加剧，Q2 价格下降至较低水平，公司盈利承压
锦浪科技	2024H1 公司并网逆变器业务实现营收 20.5 亿元，同比-8.02%
固德威	预计下半年欧洲户用光储系统需求有望回归合理水平
德业股份	2024H1 逆变器实现营收 23.22 亿元，同比-26.06%
昱能科技	欧洲市场去库存加速
上能电气	今年以来中东、印度、非洲、东南亚、南亚等新兴市场光伏装机容量不断上升，但电网基础较弱
隆基绿能	2024H1 组件出货量 31.34GW，其中亚太区域销量同比大幅增长超 140%

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

## 5.5. 储能：全球储能需求旺盛，中国市场价格竞争加剧，欧洲市场库存去化下需求放缓

8 月，全球储能需求旺盛，中国市场价格竞争加剧，欧洲市场库存去化下需求放缓。

表 13：储能厂商最新动态

厂商	8 月动态
阳光电源	暂时还未看到储能天花板，预计未来会保持较高增速中东市场大储需求和公司份额快速增加
科士达	欧洲户储的市场需求增速放缓公司下游客户仍存在库存压力，放缓提货安排
上能电气	2024H1 储能双向变流器及系统集成产品业务营收 5.07 亿元，同比下降 37.96%
科陆电子	2024H1 储能营收 4.6 亿元，同比大增 240%
宁德时代	国内储能行业存在价格方面过度竞争的现象
锦浪科技	2024Q2 海外储能逆变器的接单量持续向好，出货量增长带动盈利提升
固德威	受欧洲户储库存去化影响，海外需求下滑，公司高毛利产品储能逆变器下降
科华数据	中国市场上储能等新能源竞争压力加大
德业股份	2024H1 储能逆变器毛利率保持稳定
昱能科技	2024H1 公司工商储业务收入达到 1.78 亿元已超去年全年水平
天合光能	2024H1 储能业务实现出货 1.7GWh，同比增长 293.3%

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

## 5.6. 服务器：AI 服务器需求保持强劲，通用服务器需求也逐渐反弹

8 月，AI 服务器需求保持强劲，通用服务器需求也逐渐反弹。

表 14：服务器厂商最新动态

厂商	8 月动态
三星电子	服务器市场整体需求保持强劲;预计 2024 年 HBM 供应链同比增长 3 倍以上，服务器 SSD 出货量同比增长 80%
浪潮	2024H1 服务器行业市场需求逐步改善
联想	2024Q2 公司 AI 服务器 pipeline(潜在意向订单)环比增长 20%以上、order(在手订单)环比增长 50%
戴尔	2024Q2 服务器营收 31 亿美元，环比增长 82%，积压订单达 38 亿美元;

	重组销售团队并裁员 1.25 万人，成立 AI 新团队
NVIDIA	Hopper 需求持续强劲，Blackwell 将在 Q4 开始以数十亿美元的规模出货
HPE	AI 服务器订单持续增长

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

### 5.7. 通信：通信业务增长低迷，头部厂商逐步剥离部分资产以降低成本

8 月，通信业务增长低迷，头部厂商逐步剥离部分资产以降低成本。

表 15：通信厂商最新动态

厂商	8 月动态
三星电子	2024Q2 网络业务(NW)利润环比、同比均为小幅个位数负增长
华为	2024H1 通信相关业务保持稳健
思科	10 亿美元将美国呼叫路由业务 Iconnectiv 出售给科赫
爱立信	2024Q2 北美市场恢复增长;通信行业投资水平持续走低
诺基亚	拟 100 亿美元出售移动网络部门
中兴通讯	2024H1 运营商网络营收 372.96 亿元，同比减少 8.61%;5G 基站、5G 核心网发货量保持全球第二

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

## 6. 上周（09/02-09/06）半导体行情回顾

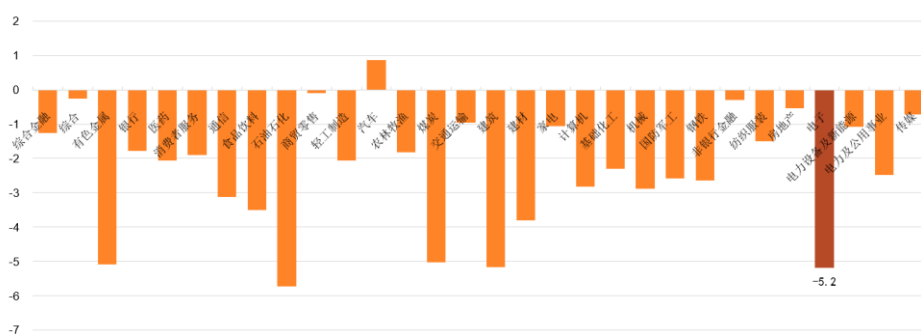
上周（09/02-09/06）半导体行情落后于大部分主要指数。上周创业板指数下降 2.68%，上证综指下跌 2.69%，深证综指下降 2.61%，中小板指下降 2.95%，万得全 A 下降 2.50%，申万半导体行业指数下降 5.88%。

表 16：上周半导体行情与主要指数对比

	本周涨跌幅%	半导体行业相对涨跌幅 (%)
创业板指数	-2.68	-3.20
上证综合指数	-2.69	-3.20
深证综合指数	-2.61	-3.28
中小板指数	-2.95	-2.93
万得全 A	-2.50	-3.38
半导体（申万）	-5.88	-

资料来源：Wind，天风证券研究所

图 44：上周 A 股各行业行情对比 (%)

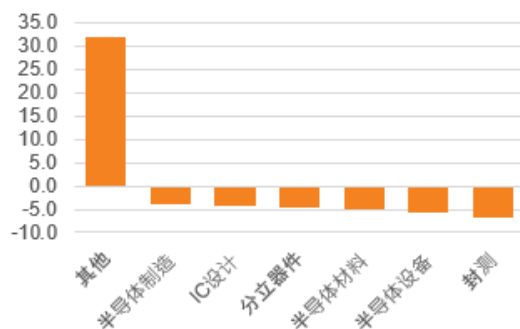


资料来源：Wind，天风证券研究所

半导体各细分板块有涨有跌，其他板块涨幅最大，封测板块跌幅最大。半导体细分板块中，封测板块上周下降 6.7%，半导体材料板块上周下降 5.1%，分立器件板块上周下降 4.7%，IC

设计板块上周下降 4.1%，半导体设备板块上周下降 5.6%，半导体制造板块上周下降 4.1%，其他板块上周上涨 32.0%。

图 45：上周子板块涨跌幅（%）



资料来源：Wind，天风证券研究所

上周半导体板块涨幅前 10 的个股为：龙芯中科、睿创微纳、华润微、国民技术、裕太微-U、概伦电子、派瑞股份、盈方微、芯联集成-U、慧智微-U。

上周半导体板块跌幅前 10 的个股为：纳芯微、源杰科技、中微公司、盛美上海、华海清科、德明利、拓荆科技、恒玄科技、北方华创、寒武纪-U。

表 17：上周涨跌幅前十半导体个股

本周涨幅前 10	涨跌幅%	本周跌幅前 10	涨跌幅%
龙芯中科	2.88	纳芯微	-7.12
睿创微纳	1.55	源杰科技	-7.48
华润微	0.59	中微公司	-7.64
国民技术	0.56	盛美上海	-9.22
裕太微-U	0.47	华海清科	-9.34
概伦电子	0.05	德明利	-9.52
派瑞股份	0.03	拓荆科技	-9.60
盈方微	-0.11	恒玄科技	-10.96
芯联集成-U	-0.16	北方华创	-20.18
慧智微-U	-0.16	寒武纪-U	-41.51

资料来源：Wind，天风证券研究所

## 7. 上周（09/02-09/06）重点公司公告

### 【华亚智能 003043.SH】

公司 9 月 3 日发布公告披露重组进程，其中买方机构为苏州华亚智能科技有限公司，卖方机构为蒯海波、徐军、徐飞、刘世严，交易标的为苏州冠鸿智能装备有限公司 51% 股权，公司拟向四位股东发行股份购买资产，每人获得 1,629,426 股，同时发行股份以募集不超过 284,172,000 元的资金。

### 【瑞芯微 603893.SH】

公司 9 月 3 日发布报告称，瑞芯微电子股份有限公司股东黄旭在 2024 年 6 月 28 日至 8 月 30 日期间通过集中竞价交易减持了公司 0.98% 的股份，共计 4,083,008 股。由于公司股权激励计划和股票回购注销等活动，黄旭先生的持股比例被动稀释了 0.02%，导致其持股比例变动累计超过 1%。

### 【北方华创 002371.SZ】

公司 9 月 5 日发布公告披露重组进程，北方华创科技集团股份有限公司接到实际控制人北

京电子控股有限责任公司的通知，计划将七星集团持有的北方华创 33.61% 股权无偿划转给北京电控。划转完成后，北京电控将成为控股股东，而七星集团将不再持有股份。尽管控股股东变更，公司的实际控制人仍为北京电控。相关信息已在 2023 年 11 月 17 日的公告中披露。

## 8. 上周（09/02-09/06）半导体重点新闻

**全球 AI 芯片峰会终极议程出炉，46 场演讲正式揭晓。**2024 年 9 月 6 日至 7 日，第六届全球 AI 芯片峰会（GACS 2024）将在北京辽宁大厦举行。此次峰会由芯东西和智猩猩联合主办，主题为“智算纪元 共筑芯路”，涵盖主会议、技术论坛和展览展示。主会议包括开幕式及三个专场会议，而技术论坛则设有 Chiplet 关键技术、智算集群技术以及中国 RISC-V 计算芯片创新等议题。经过精心筹备，峰会已邀请超过 50 位行业专家，他们将就 AI 芯片、Chiplet、RISC-V 等领域进行主旨报告和讨论。此外，包括惠普、DriveNets、力科公司等 11 家公司将在峰会上展示其最新技术与产品，同时，峰会还将揭晓 AIIP AI 生产力创新先锋企业榜单。

**TI 推出超小型 DLP 显示控制器，推动投影显示技术迈入新时代。**德州仪器（TI）推出了 DLPC8445，一款超小型 DLP 显示控制器，它能够实现 4K 超高清投影机的小体积、高速度 and 低功耗。这款控制器的尺寸仅为 9mm × 9mm，比上一代产品缩小了 90%，为其他电子元件留出更多空间，有助于缩小整体系统尺寸，标志着投影显示技术进入新时代。

**英特尔与腾讯持续深化合作，为智算未来注入新动力。**在 2024 腾讯全球数字生态大会上，英特尔展示了与腾讯在多个技术领域的合作成果，包括 AI、云计算、数据库、存储、网络和游戏。腾讯云宣布将推出搭载英特尔至强 6 处理器的新一代云实例。双方还探讨了如何挖掘数据价值，以帮助企业在 AI 时代抓住更多机遇。英特尔强调 AI 技术在推动行业变革和数据中心演进中的作用，并表示英特尔致力于与腾讯合作，开发高效的解决方案，以支持新趋势和产业的发展。

## 9. 风险提示

**地缘政治带来的不可预测风险：**随着地缘政治冲突加剧，美国等国家/地区相继收紧针对半导体行业的出口管制政策，国际出口管制态势趋严，经济全球化受到较大挑战，对全球半导体市场和芯片供应链稳定带来不确定风险。未来如美国或其他国家/地区与中国的贸易摩擦升级，限制进出口及投资，提高关税或设置其他贸易壁垒，半导体行业相关公司还可能面临相关受管制设备、原材料、零备件、软件及服务支持等生产资料供应紧张、融资受限的风险等，进而对行业内公司的研发、生产、经营、业务造成不利影响。

**需求复苏不及预期：**受到全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，集成电路行业存在一定的周期性，与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，集成电路行业的市场需求也将随之受到影响。另外，下游市场需求的波动和低迷亦会导致集成电路产品的需求下降，或由于半导体行业出现投资过热、重复建设的情况进而导致产能供应在景气度较低时超过市场需求。

**技术迭代不及预期：**集成电路行业属于技术密集型行业，集成电路涉及数十种科学技术及工程领域学科知识的综合应用，具有工艺技术迭代快、资金投入大、研发周期长等特点。多年来，集成电路行业公司坚持自主研发的道路并进一步巩固自主化核心知识产权。如果

行业内公司未来技术研发的投入不足，不能支撑技术升级的需要，可能导致公司技术被赶超或替代，进而对公司的持续竞争力产生不利影响。

**产业政策变化风险：**集成电路产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性产业。国家陆续出台了包括《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发[2020]8号）在内的一系列政策，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等方面为集成电路企业提供了更多的支持。未来如果国家相关产业政策出现重大不利变化，将对行业发展产生一定不利影响。



## 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

## 一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

## 特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

## 投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

## 天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区德胜国际中心 B 座 11 层	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100088	A 栋 23 层 2301 房	邮编：200086	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	邮编：570102	电话：(8621)-65055515	电话：(86755)-23915663
	电话：(0898)-65365390	传真：(8621)-61069806	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com